



股票代號:7810

捷創科技股份有限公司  
Jtron Technology Corp.

民國一一三年度  
年報

查詢網址：[mops.twse.com.tw](http://mops.twse.com.tw)

查詢網址：[www.jtron-tech.com](http://www.jtron-tech.com)

中華民國一十四年四月十五日刊印

一、 發言人及代理發言人：

發言人姓名：鄭文吉

職稱：財務管理處副總經理

電話：(03)563-8886

E-mail：ir@jtron-tech.com

代理發言人姓名：胡嘉禎

職稱：營運管理處副總經理

電話：(03)563-8886

E-mail：ir@jtron-tech.com

二、 總公司、分公司及工廠之地址及電話：

總公司地址：新竹市東區關新里關新路 27 號 6 樓之 1

總公司電話：(03)563-8886

分公司及工廠之地址及電話：無

三、 股票過戶機構：

機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市大安區敦化南路二段 67 號地下 1 樓

電話：(02)2586-5859

網址：www.yuanta.com.tw/eyuanta/agent

四、 最近年度財務報告簽證會計師：

會計師姓名：葉東輝會計師、溫智源會計師

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地址：新竹市東區科學工業園區展業一路 2 號 6 樓

電話：(03)578-0899

網址：www.deloitte.com.tw

五、 海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢方式：不適用。

六、 公司網址：www.jtron-tech.com

## 目錄

壹、 致股東報告書.....	1
貳、 公司治理報告.....	5
一、 董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	5
二、 最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金.....	10
三、 公司治理運作情形.....	16
四、 簽證會計師公費資訊.....	32
五、 更換會計師資訊.....	32
六、 公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者.....	33
七、 最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形.....	33
八、 持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊.....	34
九、 公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例.....	34
參、 募資情形.....	35
一、 資本與股份.....	35
二、 公司債辦理情形.....	37
三、 特別股辦理情形.....	37
四、 海外存託憑證辦理情形.....	37
五、 員工認股權憑證辦理情形.....	37
六、 限制員工權利新股辦理情形.....	37
七、 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	37
八、 資金運用計畫執行情形.....	37
肆、 營運概況.....	38
一、 業務內容.....	38
二、 市場及產銷概況.....	46
三、 從業員工資料.....	52
四、 環保支出資訊.....	53
五、 勞資關係.....	53
六、 資通安全管理.....	54

七、 重要契約 .....	55
<b>伍、 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 .....</b>	<b>56</b>
一、 財務狀況 .....	56
二、 財務績效 .....	57
三、 現金流量 .....	58
四、 最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	58
五、 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫.....	58
六、 最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估.....	59
七、 其他重要事項 .....	62
<b>陸、 特別記載事項.....</b>	<b>62</b>
一、 關係企業相關資料 .....	62
二、 私募有價證券辦理情形 .....	62
三、 其他必要補充說明事項 .....	62
四、 最近年度及截至年報刊印日止，如發生本法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 .....	62

## 壹、致股東報告書

歡迎各位股東出席本公司 114 年股東常會，並感謝各位股東的支持與愛護，謹將本公司 113 年度之營運狀況說明如下：

### 一、113 年度營業結果

#### (一) 113 年度營業計劃實施成果：

近年企業因疫情而加速數位轉型，對半導體需求暢旺，進而驅動半導體業者積極投資擴廠，帶動我國半導體設備業產值於 109 年起突破千億元水準，年增 47.3%，之後連續 3 年呈高速雙位數成長，惟隨全球步入高通膨及高利率環境後，消費及設備投資動能均放緩，112 年產值轉年減 7.3%，結束自 101 年以來連續 11 年成長趨勢，113 年度隨 AI 商機浪潮崛起對高效能運算、人工智慧應用之需求強勁，再度加速市場對半導體先進製程之產能需求，據 WSTS（全球半導體貿易統計協會）預測，113 年全球半導體市場年增 19%，產值將達到 6,270 億美元；114 年全球半導體市場產值將達到 6,970 億美元，年增 11.2%。另根據工研院產科所預估，113 年台灣半導體產業產值達 5 兆 3,001 億元台幣，年增 22%。

本公司 113 年度亦受到市場上對高效能運算、人工智慧應用需求所衍生之半導體先進製程之產能需求，相關設備技術工程服務需求較 112 年度增加。此外設備延壽服務部分，延續過往之基礎，營收亦較 112 年度成長。在自有/代理產品銷售方面，配合半導體製程設備新裝機之增加，及 Smart manufacture& Lab. 相關之產品出貨增加，較 112 年度成長 50% 以上，使 113 年度之收入與毛利較 112 年度分別增加 21% 及 26%，達 441,720 千元及 204,800 千元。營業費用因用人成本、現金增資所產生之員工酬勞成本、研發用料增加及 112 年度預期信用減損迴轉利益 9,580 千元等因素較 112 年增加 31%，達 148,092 千元，營業利益較 112 年增加 15%，達 56,708 千元，營業外收入與支出部分因 112 年度借款還款，致相關財務成本減少，利息收入及匯兌利益增加等因素，使營業外收入與支出達 30,801 千元，較 112 年度增加 69%。綜上，113 年度之稅前利益達 87,509 千元，較 112 年度增加 29%。

#### (二) 預算執行情形

本公司 113 年度並未公開財務預測資訊，實際營運結果請參閱財務報告。

#### (三) 財務收支及獲利分析

本公司 113 及 112 年度財務收支分析如下：

單位：新台幣千元

項目	113 年		112 年		增(減)情形	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	441,720	100%	365,606	100%	76,114	21%
營業毛利	204,800	46%	162,401	45%	42,399	26%
營業利益	56,708	13%	49,370	14%	7,338	15%
稅前淨利	87,509	20%	67,584	19%	19,925	29%
稅後淨利	68,034	15%	56,699	16%	11,335	20%

本公司 113 及 112 年度獲利能力分析如下：

單位：新台幣千元

項目		113 年	112 年	增(減)比例(%)	
財務收支	營業收入	441,720	365,606	21%	
	營業毛利	204,800	162,401	26%	
	稅前淨利	87,509	67,584	29%	
獲利能力	資產報酬率(%)	10%	11%	(9%)	
	權益報酬率(%)	13%	17%	(24%)	
	估實收資本比率(%)	營業利益	32%	35%	(9%)
		稅前淨利	49%	48%	2%
純益率(%)	15%	16%	(6%)		

#### (四) 研究發展狀況

本公司業務係以設備技術工程服務為主，隨著半導體產業的發展，逐漸發展設備延壽服務與銷售、設備儀器之維修服務，並由於客戶之需求與執行工作時發現之製程效率提升之商機，漸漸擴展到為所提供服務客戶之設備周邊之軟、硬體之整合與改良等業務。於 113 年度確立在原有的核心業務外，衍生出以 Smart Manufacturing/Smart Lab. 為主軸之產品與服務，透過與設備原廠與客戶之合作下，能依據客戶的不同需求，在不入侵/改造/破壞設備之條件下，可以協助客戶達成收集機台及環境參數、遠端監控與智能控管、整合資訊與單一溝通之 EAP(Equipment Automatic Program)解決方案，及推出如 93K Hexa Clamper 等各類提升客戶生產效率或良率之治具或配件。113 年度研發費用投入計 34,965 千元，較 112 年度增加約 9.5%。

## 二、本年度(114 年度)營業計畫概要

### (一) 營運方針

本公司以創新、誠信及專業的服務態度，擁有專業之工程服務與產品開發之團隊，成為全球著名半導體設備原廠於設備工程技術服務之長期策略合作夥伴。

此外，半導體設備原廠終止產品支援服務後，本公司接續原廠亦提供原廠級之保修服務，使終端客戶之設備可以持續運作。我們致力於為客戶提供最佳的測試整合解決方案，藉由與時俱進專業可靠的技術服務平台，期許本公司在客戶產品與技術發展進程中，成為企業最值得信賴的夥伴。

## (二)營業目標與重要產銷政策

近期因市場上對高效能運算、人工智慧應用需求所衍生之半導體先進製程之產能需求大增，本公司將與設備原廠緊密配合，來滿足客戶裝機、設備維護需求。此外工廠、實驗室自(智)動化需求隨著各項技術日漸成熟、人力短缺等條件下，需求日增。本公司將既有業務基礎之下擴大業務範圍，強化與客戶的關係。

## 三、未來公司發展策略

因應外在產業景氣發展，本公司團隊將積極整合內外部資源持續投入各項工程技術服務之效率與能量、產品與專案研發及業務拓展，除了在原有的半導體測試設備維護相關領域合作夥伴外，也結合既有的平台和區域優勢進入如智慧實驗室與智慧生產等新的領域，期望在未來幾年內公司也能在跨領域的整合專案中能有持續穩定之成果。

## 四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

回顧 113 年，國際環境依舊衝突不斷，除了已持續數年的烏克蘭戰爭，又發生以巴衝突和中東國家的多邊對峙，再加上持續的中美間大國競爭與美國大選年的衝擊，世界整體的政治與經濟環境都面臨相對嚴峻的挑戰。國內外各產業對市場預估也相對趨向保守。惟 113 下半年隨著 AI 運用爆發與矽光子相關運用發酵，加上半導體先進封裝測試需求大增，半導體科技產業環境也朝正向轉變，提供了更多的業務機會和成長空間，本公司也因應市場和客戶需求趨勢在經營與開發端投入資源做最有效的管理，將本公司的團隊優勢發揮到最佳化，除維持既有業務外更持續開創新的業務機會和領域。

在 113 年 5 月 20 日，我們懷著無比興奮的心情，共同慶祝捷創科技 20 周年。在 12 月 25 日，捷創科技(7810)正式通過公開發行公司，並於 114 年 1 月 3 日正式登錄興櫃成為 114 年第一家在興櫃市場掛牌交易的公司，市場也給本公司相對積極與正面的回應。二十周年與公發興櫃不僅是慶祝過去的成就，更是本公司新征程的起點，公司經營團隊期許未來以更高的標準推動公司發展，將本公司帶向另一層次的高峰。

展望 114 年，半導體科技產業持續熱絡，AI 相關運用也在各產業積極擴展，本公司將挹注更多資源來掌握機會，讓本公司多年的辛勤耕耘得以開花結果。

敬祝 各位股東女士、先生

身體健康 萬事如意

捷創科技股份有限公司



董事長 林益民



貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事與監察人

1. 董事及監察人基本資料

114年3月25日 單位：股；%

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選任日期	任期(年)	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	捷創集成股份有限公司	-	113.06.26	3	96.09.06	3,835,768	27.44	4,301,567	23.90	-	-	-	-	-	鯨揚科技(股)公司董事	-	-	-	-
	中華民國	代表人：林益民	男 51~60	113.06.26	3	96.09.06	372,955	2.66	412,955	2.29	-	-	1,710,248	9.50	Santa Clara University/ 電機工程所 成功大學/電機工程系 工研院電子所/工程師 惠普科技/工程師 京元電子/處長 柏晶電子/總經理	本公司總經理 捷創集成(股)公司董事長 玄力科技(股)公司董事長 傳晶投資有限公司董事 迪麥科技(股)公司董事 捷創微精量測(股)公司董事長 技鼎(股)公司董事 JTRON (SAP) PTE LTD 董事 HANBIT-JTRON, INC. 董事 寰鼎集成電路(上海)有限公司董事	-	-	-	-
董事	中華民國	迅英投資有限公司	-	113.06.26	3	103.07.11	1,251,111	8.94	1,347,111	7.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中華民國	代表人：胡嘉禎	女 51~60	113.06.26	3	103.07.11	212,125	1.52	242,125	1.35	-	-	1,347,111	7.48	輔仁大學/社會系 京元電子/業務副理	本公司副總經理 迅英投資有限公司董事 捷創集成(股)公司董事 捷創微精量測(股)公司監察人	-	-	-	-

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選任日期	任期(年)	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	溫在昇	男 51~60	113.06.26	3	112.08.09	185,499	1.32	215,499	1.20	-	-	-	-	逢甲大學/電機工程系 海洋大學/電機工程所 安捷倫科技/協理	本公司副總經理 捷創集成(股)公司董事 柏晶電子(上海)有限公司監察人 柏晶電子(南京)有限公司監察人	-	-	-	-
董事	中華民國	鄭文吉	男 51~60	113.06.26	3	113.06.26	115,000	0.82	164,000	0.91	-	-	-	-	臺北大學/會計學所 中興大學法商學院/會計系 技鼎公司/董事長特助 盟圖科技/財務部經理 宇力電子/財務部經理 安侯建業聯合會計師事務所資深經理	本公司副總經理 迅杰科技(股)公司獨立董事 莎菲特國際(股)公司監察人 捷覈科技(股)公司監察人 震鼎集成(上海)有限公司監察人	-	-	-	-
董事	中華民國	李秋燕	女 51~60	113.06.26	3	113.06.26	67,749	0.48	67,749	0.38	-	-	-	-	中正大學會計學碩士 台灣大學管理學士 廣信益群聯合會計師事務所 合夥會計師	廣信投資(股)公司董事 廣信益群聯合會計師事務所 合夥會計師	-	-	-	-
監察人	中華民國	梁立恒	男 61~70	113.06.26	3	113.06.26	16,500	0.12	46,500	0.26	-	-	-	-	逢甲大學電機系 宇範科技(股)公司總經理	宇範科技(股)公司董事長	-	-	-	-
監察人	中華民國	廖瑞萍	女 51~60	113.11.20	3	113.11.20	-	-	6,000	0.03	-	-	-	-	親民工專企管系 太空梭高傳真資訊科技(股)公司稽核專員	耀群科技(股)公司副總經理	-	-	-	-

## 2. 法人股東之主要股東

114年3月25日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
捷創集成股份有限公司	傳晶投資有限公司(56%)、宏潔投資有限公司(26%)、迅英投資有限公司(18%)
迅英投資有限公司	胡嘉禎(46%)、張哲滄(46%)、張昕霖(4%)、張昕宇(4%)

## 3. 法人股東之主要股東為法人者其主要股東

114年3月25日

法人名稱	法人之主要股東
傳晶投資有限公司	林則鈺(40.74%)、林則均(40.74%)、林益民(10%)、俞思瑩(8.52%)
迅英投資有限公司	胡嘉禎(46%)、張哲滄(46%)、張昕霖(4%)、張昕宇(4%)
宏潔投資有限公司	楊寶琳(52%)、溫在昇(40%)、溫孟潔(8%)

## 4. 董事及監察人專業資格及獨立性資訊揭露

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
捷創集成股份有限公司 代表人：林益民		1.具備商務、業務所需之工作及經驗 2.相關學經歷請參閱(一)董事及監察人資料 3.未有公司法第30條各款情事	與其他董事或監察人間無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定之情事	-
溫在昇		1.具備商務、業務所需之工作及經驗 2.相關學經歷請參閱(一)董事及監察人資料 3.未有公司法第30條各款情事		-
迅英投資有限公司 代表人：胡嘉禎		1.具備商務、業務所需之工作及經驗 2.相關學經歷請參閱(一)董事及監察人資料 3.未有公司法第30條各款情事		-
李秋燕		1.具備商務、業務所需之工作及經驗 2.相關學經歷請參閱(一)董事及監察人資料 3.未有公司法第30條各款情事		-
鄭文吉		1.具備商務、業務所需之工作及經驗 2.相關學經歷請參閱(一)董事及監察人資料 3.未有公司法第30條各款情事		1
梁立恒		1.具備商務、業務所需之工作及經驗 2.相關學經歷請參閱(一)董事及監察人資料 3.未有公司法第30條各款情事		-
廖瑞萍		1.具備商務、業務所需之工作及經驗 2.相關學經歷請參閱(一)董事及監察人資料 3.未有公司法第30條各款情事		-

## 5. 董事會多元化及獨立性

### (1) 董事會多元化：

衡諸本公司目前董事會 5 名董事及 2 名監察人，整體具備營業判斷及業務開發、會計及財務分析、經營管理及服務研發、風險管理及危機處理、產業知識、國際市場觀、領導決策暨環境永續及社會參與等多元能力及經驗。董事會成員皆為本國籍；女性成員占比為 42.86%；成員年齡分布區間計有 1 名成員年齡位於 61-70 歲及 6 名成員位於 51-60 歲。未來仍就視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

### (2) 董事會獨立性：

本公司董事或監察人間無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定之情事。

本公司將於本次股東常會依證券交易法第十四條之二規定完成設置獨立董事，有關獨立董事之選任及資格將遵循「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定。此外，亦將設立審計委員會等功能性委員會，健全並強化公司治理。

(二) 總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管資料

114年3月25日 單位：股；%

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	林益民	男	93.06.01	412,955	2.29	-	-	1,710,248	9.5	Santa Clara University/電機工程所 成功大學/電機工程系 工研院電子所/工程師 惠普科技/工程師 京元電子/處長	捷創集成(股)公司董事長 玄力科技(股)公司董事長 傳晶投資有限公司董事 迪麥科技(股)公司董事 捷創微精量測(股)公司董事長 技鼎(股)公司董事 JTRON (SAP) PTE LTD. 董事 HANBIT-JTRON, INC. 董事 寰鼎集成電路(上海)有限公司董事	-	-	-	-
副總經理	中華民國	溫在昇	男	112.12.01	215,499	1.20	-	-	-	-	海洋大學/電機工程系/博士 逢甲大學/電機工程系 安捷倫科技/協理	捷創集成(股)公司董事 柏晶電子(上海)有限公司監察人 柏晶電子(南京)有限公司監察人	-	-	-	-
副總經理	中華民國	柯鴻毅	男	111.01.01	225,175	1.25	-	-	-	-	中華大學/電機工程系 京元電子/處長 晶讚光電/協理	-	-	-	-	
副總經理	中華民國	胡嘉禎	女	111.04.01	242,125	1.35	-	-	1,347,111	7.48	輔仁大學/社會系 京元電子/業務副理	迅英投資有限公司董事 捷創集成(股)公司董事 捷創微精量測(股)公司監察人	-	-	-	-
副總經理	中華民國	鄭文吉	男	112.04.01	164,000	0.91	-	-	-	-	臺北大學/會計學所 中興大學法商學院/會計系 技鼎公司/董事長特助 盟圖科技/財務部經理 宇力電子/財務部經理 安侯建業聯合會計師事務所資深經理	迅杰科技(股)公司獨立董事 莎菲特國際(股)公司監察人 捷叢科技(股)公司監察人 寰鼎集成(上海)有限公司監察人	-	-	-	-
協理	中華民國	林志敏	男	114.01.01	73,324	0.41	-	-	245,000	1.36	大華技術學院/電子工程系 國立勤益工專/電子工程系 愛德萬測試(股)公司/業務經理	華谷投資有限公司董事 威柏投資有限公司董事	-	-	-	-

(三) 最高經理人與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露之相關資訊

本公司董事長與總經理為同一人，係為提升經營效率與決策執行力。此外，董事長平時亦密切與各董事充分溝通公司營運近況與計劃方針以落實公司治理，本公司除每年度安排各董事參加外部機構專業董事課程，以增進董事會運作效能外，並



酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	捷創集成(股)公司代表人： 林益民、溫在昇、迅英投資 有限公司代表人：胡嘉禎、 李秋燕、鄭文吉	捷創集成(股)公司代表人： 林益民、溫在昇、迅英投資 有限公司代表人：胡嘉禎、 李秋燕、鄭文吉	李秋燕	李秋燕
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)				
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	-	-	迅英投資有限公司 代表人：胡嘉禎、鄭文吉	迅英投資有限公司 代表人：胡嘉禎、鄭文吉
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	-	-	溫在昇	溫在昇
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	-	-	捷創集成(股)公司 代表人：林益民	捷創集成(股)公司 代表人：林益民
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	-	-		
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	-	-		
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	-	-	-	-
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總計	5 人	5 人	5 人	5 人

(二) 監察人之酬金

113 年度；單位：新台幣千元；千股；%

職稱	姓名	監察人酬金						A、B 及 C 等三項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		報酬(A)		酬勞(B)		業務執行費用(C)		本公司	財務報告內所有公司	
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司			
監察人	傳晶投資有限公司 代表人：俞思瑩(註 1) 梁立恒(註 2) 廖瑞萍(註 3)	-	-	471	471	12	12	483; 0.71%	483; 0.71%	無

註 1：於 113 年 11 月 19 日解任。

註 2：於 113 年 6 月 26 日新任。

註 3：於 113 年 11 月 20 日新任。

酬金級距表

給付本公司各個監察人酬金級距	監察人姓名	
	前三項酬金總額(A+B+C)	
	本公司	財務報告內所有公司 D
低於 2,000,000 元	傳晶投資有限公司代表人：俞思瑩、梁立恒、廖瑞萍	傳晶投資有限公司代表人：俞思瑩、梁立恒、廖瑞萍
2,000,000 元(含)~5,000,000 元(不含)		
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)		
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)		
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)		
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)		
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)		
100,000,000 元以上		
總計	3 人	3 人

(三) 總經理及副總經理之酬金

113 年度；單位：新台幣千元；千股；%

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	林益民	8,468	8,468	255	255	706	706	1,288	-	1,288	-	10,717; 15.75%	10,717; 15.75%	122
副總經理	溫在昇													
副總經理	柯鴻毅													

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司 E
低於 1,000,000 元	-	-
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	-	-
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	溫在昇、柯鴻毅	溫在昇、柯鴻毅
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	林益民	林益民
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	-	-
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	-	-
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	-	-
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	-	-
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	3 人	3 人

(四) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113 年度；單位：新台幣千元；%

	職 稱	姓 名	股票金額	現金金額 (註 1)	總 計	總額占稅後 純益之比例 (%)
經理人	總經理	林益民	-	1,832	1,832	2.69
	副總經理	溫在昇				
	副總經理	柯鴻毅				
	副總經理	胡嘉禎(註 2)				
	副總經理 財務部門主管 會計部門主管	鄭文吉(註 2)				

註 1：係依據本公司 114 年 4 月 9 日董事會通過分派之員工酬勞金額，參酌去年度分派酬勞比例計算今年擬議分派金額。

註 2：於 114 年 1 月 1 日由協理擢升為副總經理。

(五)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

1. 最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析：

單位：新台幣千元；%

項目	年度	112 年度		113 年度	
		占稅後純益比率		占稅後純益比率	
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
董事		1,328	2.34%	1,612	2.37%
監察人		393	0.69%	483	0.71%
總經理及副總經理		9,221	16.26%	10,717	15.75%

2. 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

(1) 董事及監察人：

本公司董事及監察人之報酬依公司章程之規定，公司年度如有獲利，由董事會決議提撥不高於百分之三為董監酬勞，董監酬勞以現金發放。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

(2) 總經理及副總經理：

包含薪資、獎金及員工酬勞，薪資水準係依對公司所擔任之職位、所承擔之責任及對本公司之貢獻度，並參酌同業水準議定；員工酬勞的分派標準係遵循公司章程，經董事會決議並向股東會報告後發放。

(3) 訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：

訂定酬金之程序，除了參考公司整體的營運績效，亦參考個人的績效達成率及對公司績效的貢獻度，而給予合理的報酬。除上述外，本公司將未來營運風險之可能性降至最低，隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以謀求本公司永續經營與風險控管之平衡。綜上所述，本公司支付董事、監察人、總經理及副總經理酬金之政策及訂定酬金之程序，與經營績效具有正向關聯性。

### 三、 公司治理運作情形

#### (一) 董事會運作情形

113 年度董事會開會 9 次(A)，董事及監察人出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列)席 次數 B	委託出席次數	實際出席(列)席 率(%)【B/ A】(註)	備註
董事長	捷創集成(股)公司 代表人：林益民	9	0	100	無
董事	迅英投資有限公司 代表人：胡嘉禎	9	0	100	無
董事	溫在昇	8	0	89	無
董事	鄭文吉	6	0	100	1130626 新任 應開會 6 次
董事	李秋燕	5	0	83	1130626 新任 應開會 6 次
監察人	傳晶投資有限公司 代表人：俞思瑩	1	0	17	1131119 解任 應開會 6 次
監察人	梁立恒	5	0	83	1130626 新任 應開會 6 次
監察人	廖瑞萍	2	0	67	1131120 新任 應開會 3 次

其他應記載事項：

一. 董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理

(一) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：無此情形。

(二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董會決議事項：無此情形。

二. 董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

113 年 12 月 27 日 113 年第九次董事會

董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
迅英投資有限公司 代表人：胡嘉禎	本公司經理人派任案	本案之當事人	兩位當事人迴避後，經 主席徵詢其餘出席董 事無異議照案通過
鄭文吉			

三. 上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列附表二(2)董事會評鑑執行情形：不適用。

四. 當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估：

(一) 本公司於 114 年 1 月 3 日興櫃掛牌後，承諾掛牌後六個月選任獨立董事、設置審計委員會，並致力於符合上市上櫃公司治理實務守則。另提昇資訊透明度方面，本公司網站設置投資人專區保持公司資訊更新。本屆董事會成員已取得證券法令及公司治理進修課程證明。

(二) 本公司業依「公開發行公司董事會議事辦法」訂定本公司董事會議事規範以資遵循，落實公司治理。

(三) 為使董事、監察人及經理人於執行業務時所承擔之風險能夠獲得保障，本公司已投保責任保險。

註：實際出席(列)席率(%)以其在職期間董事會開會次數及其實際出席(列)席次數計算之。

#### (二) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

1. 審計委員會運作情形：不適用

本公司於 114 年 1 月 3 日興櫃掛牌後，承諾掛牌後六個月選任獨立董事、設置審計委員會，並致力於符合上市上櫃公司治理實務守則，故暫無審計委員會運作情形之資訊。

2. 監察人參與董事會運作情形：

113 年度董事會開會 9 次(A)，列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率 (%)【B/A】(註)	備註
監察人	傳晶投資有限公司 代表人：俞思瑩	1	0	17	1131119 解任 應開會 6 次
監察人	梁立恒	5	0	83	1130626 新任 應開會 6 次
監察人	廖瑞萍	2	0	67	1131120 新任 應開會 3 次
<p>其他應記載事項：</p> <p>一. 監察人之組成及職責：            (一)監察人與公司員工及股東之溝通情形：監察人如有需要可直接與員工、股東溝通。            (二)監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形：稽核主管每月檢送前一個月稽核報告，書面呈核各監察人。            二. 監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：無。</p>					

(三)公司治理運作情形與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司將依照「公司治理實務守則」中訂定相關作業程序，並於 114 年第二次董事會決議通過。	無重大差異
二、公司股權結構及股東權益				
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		為確保股東權益，本公司已設置發言人及代理發言人並會同專業股務代理專責妥善處理股東建議。	無重大差異
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東	V		本公司定期依據股務代理機構於辦理停過時提供之股東	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>之最終控制者名單？</p> <p>(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？</p> <p>(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？</p>	V		<p>名冊，確實掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單。</p> <p>本公司訂有「關係人交易管理辦法」及「子公司監督與管理辦法」等內部相關辦法，建立適當風險控管及防火牆機制。</p> <p>本公司已訂定「內部重大資訊處理作業程序」，用以禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。</p>	<p>無重大差異</p> <p>無重大差異</p>
<p>三、董事會之組成及職責</p> <p>(一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？</p> <p>(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？</p> <p>(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董</p>	V		<p>本公司章程規定，於公開發行後，董事及監察人選任採候選人提名制度，以確保董事成員之多元性及獨立性。</p> <p>本公司目前 5 董 2 監中女性成員佔有 3 席，比例達 43%，且具有不同之專業知識之技能之董事，提供不同角度思維與貢獻，以進一步強化董事會職能。</p> <p>本公司已設置薪資報酬委員會，並承諾於興櫃掛牌後六個月內成立審計委員會。未來將視法令及實際需求情況設置其他功能性委員會。</p> <p>本公司已於 114 年度第一次董事會通過「董事會績效評估辦法」。</p>	<p>無重大差異</p> <p>無重大差異</p> <p>無重大差異</p>

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？</p> <p>(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？</p>		V	本公司尚未做定期評估。	未來將依公司需要或法令規定辦理。
<p>四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？</p>	V		本公司已於 114 年度第二次董事會通過指派總經理室副總經理鄭文吉為公司治理主管。	無重大差異
<p>五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？</p>	V		本公司建立發言人制度，定期將重要財務業務及其他相關資訊，公告於公開資訊觀測站，並於公司網站設置利害關係人專區，作為對外與利害關係人之溝通管道，使其利害關係人快速瞭解公司營運狀況，以維持其權益。	無重大差異
<p>六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？</p>	V		本公司委託元大證券股份有限公司股務代理部辦理股東會事務。	無重大差異
<p>七、資訊公開</p> <p>(一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？</p>	V		本公司網站已適度揭露公司財務、業務及公司治理資訊等相關資訊。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)?	V		本公司財務部門專責公司資訊之蒐集及重大事項之揭露工作，並已建立發言人制度。並依規定揭露相關資訊於「公開資訊觀測站」。	無重大差異
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形?		V	本公司係興櫃公司，尚無需申報第一及第三季財報；年度財務報告及第二季財務報告與各月份營收資料，均依照主管機關相關規定期限前，完成申報及公告作業。	未來將依公司需要或法令規定辦理。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)?	V		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司董事除按主管機關規定安排進修外，另參與相關由公司主動安排之進修課程。</li> <li>2. 本公司於董事會議事規則中明確訂定董事對於其利害相關之議案討論及表決應予以迴避。</li> <li>3. 本公司已為董事及重要職員購買責任保險。</li> </ol>	無重大差異
九、就臺灣證券交易所股份有限公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：本公司非為公司治理評鑑之受評公司，不適用。				

(四)薪資報酬委員會之組成及運作情形

1. 薪資報酬委員會成員資料

身分別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資酬勞委員會成員家數
外部人士/ 召集人	莊嘉文	<p><b>現職：</b> 聯緯聯合會計事務所合夥會計師</p> <p><b>主要學歷與經歷：</b> 成功大學會計學研究所碩士 中華民國會計師 勤業眾信聯合會計師事務所審計員</p> <p><b>專業資格與經驗：</b> 1. 具有會計、營運判斷能力之工作經驗且取得會計師所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。 2. 兼任永騰企業及無形資產評價公司董事。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 非為本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。</li> <li>● 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)並非持有公司股份數總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。</li> <li>● 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。</li> <li>● 無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定情事。</li> </ul>	0	
外部人士	何式剛	<p><b>現職：</b> 勤美股份有限公司總管理處主管</p> <p><b>主要學歷與經歷：</b> 台灣大學經濟系碩士在職專班 安侯建業聯合會計師事務所</p> <p><b>專業資格與經驗：</b> 1. 具有會計、營運判斷能力之工作經驗且取得會計師所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。 2. 兼任日華金典國際酒店股份有限公司董事、化新精密工業股份有限公司監察人、CMJ Co., Ltd. 監察人及新密(開曼)工業股份有限公司監察人。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 非為本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。</li> <li>● 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)並非持有公司股份數總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。</li> <li>● 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。</li> <li>● 無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定情事。</li> </ul>	0	

身分別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資酬勞委員會成員家數
外部人士	林家弘		<b>現職：</b> 鯨揚科技股份有限公司總經理 <b>主要學歷與經歷：</b> 華梵人文科技學院電子工程學系 <b>專業資格與經驗：</b> 1. 具有商務、科技、營運判斷能力所須之工作經驗。 2. 鯨天有限公司董事。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 非為本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。</li> <li>● 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)並非持有公司股份數總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。</li> <li>● 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。</li> <li>● 無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定情事。</li> </ul>	0

2. 本公司之薪資酬勞委員會委員共 3 人。

3. 本屆任期自 113 年 10 月 3 日至 116 年 6 月 25 日止。113 年度共召開 3 次會議 (A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (B/A)	備註
本屆召集人	莊嘉文	3	0	100%	
委員	何式剛	2	0	100%	113.12.5. 委任
委員	林家弘	3	0	100%	

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情事。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

4. 113 年度薪資報酬委員會決議事項及執行情形：

日期/期別	議案內容	決議情形	公司對於成員意見之處理	執行情形
113 年 10 月 3 日 第一屆第一次	選任召集人	全體委員推舉鍾文凱委員為召集人	無	已依決議執行
113 年 12 月 4 日 第一屆第二次	重新選任召集人	全體出席委員推舉莊嘉文委員為召集人	無	已依決議執行
113 年 12 月 26 日 第一屆第三次	本公司經理人派任案	經薪資報酬委員會無異議通過派任胡嘉禎、鄭文吉擔任本公司副總經理一職，派任林志敏為本公司協理	無	113 年 12 月 27 日經董事會通過，同日公告，114 年 1 月 1 日生效

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

1. 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		本公司於 114 年 4 月 1 日設置永續發展室，負責推動公司永續發展相關事務。	無重大差異
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？		V	本公司已訂有「永續發展實務守則」，惟相關執行將於 114 年度展開。	未來將依公司需要或法令規定辦理。
三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		為了減少環境衝擊，本公司不使用禁用的物質與原料，節省能源及預防環境污染。	無重大差異

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		本公司鼓勵員工落實資源分類，加強資源回收，並針對辦公室空調及照明使用節能設計，以達到節能目的。	無重大差異
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	V		公司考量營運對生態效益之影響，落實及宣導環境保護之重要性及氣候變遷之潛在影響評估，以達成加強環境保護之目標。 本公司致力於節約能源、回收廢棄物、遵守環保法規，並承諾污染預防與持續改善。	無重大差異
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		本公司尚未統計相關資訊，預計 114 年度導入 GHG Protocol，執行溫室氣體盤查工作。	未來將依公司需要或法令規定辦理。
<b>四、社會議題</b>				
(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		本公司遵守相關勞動法規及依據聯合國世界人權宣言揭示然全政策宣言，並依法令規章制定相關之管理政策及程序。	無重大差異
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V		本公司已訂定及實施薪酬、績效考核、績效獎金、調薪政策、休假制度及員工福利等；並將經營績效或成果均反映於員工績效獎金及調薪。	無重大差異

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		本公司針對同仁工作環境與人身安全部份，透過管理制度的推行，加強公司環境維護與同仁作業之安全管理，定期依法辦理作業環境檢測、年度員工健康檢查等，以及舉辦各項教育課程，提升同仁危害意識，降低危害發生。	無重大差異
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		本公司安排員工參加內外之職能訓練課程，透過職能設計及培訓發展，兼顧通才與專才之發展，使每位同仁得依其發展意向，規劃個人職涯路徑。 本公司亦對中高階主轉進行MCIP之訓練，透過定期管理經驗心得分享、案例分析、會議、定期會談等方式，培養公司所需之重要幹部。	無重大差異
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		本公司與客戶間保持良好之溝通管道並對產品與服務等提供透明且有效之客訴處理程序，將申訴內容提供予內部相關單位擬訂有效之因應對策方案。	無重大差異
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		本公司採購或簽約前會評估合作期間供應商之企業社會責任之紀錄，雖目前與供應商簽定契約時尚未包含企業社會責任政策，公司未來將加強並要求與供應	無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			商簽定包含遵守雙方之企業社會責任政策，及供應商如涉及違反之政策。	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		V	本公司尚未編製企業社會責任報告書。	未來將依公司需要或法令規定辦理。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無重大差異。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：無。				

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？ (二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風		V	本公司已制定「誠信經營守則」，並於114年4月9日提報董事會修訂審議通過，明定本公司員工誠信行為守則、防止利益衝突措施及不誠信行為之風險評估機制及風險管理施等規定，以防範不誠信行為。 本公司於114年4月9日提報董事會修訂審議通過「誠信經營作業程序及行為指南」，訂有不誠信行為之防範、	無重大差異  無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	V		作業程序及申訴制度，並落實執行。	無重大差異
	V		本公司為防範不誠信行為之發生，於本公司員工在聘僱時皆有簽署勞動契約及保密切結書，其中內容包含防範相關不誠信行為之條款在內，並且在工作規則及員工手冊中明定懲處標準，導引公司同仁之行為符合道德規範，防止違法情事發生。本公司 113 年執行員工宣導誠信行為之重要性一次。	
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p> <p>(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p>	V		本公司以公開透明方式進行商業活動，交易前必先評估往來對象之基本資料，避免與有不誠信行為交易對象往來，若涉有不誠信行為且情節重大致危害本公司權益者，本公司得隨時終止或解除契約。	無重大差異
	V		本公司指定營運管理處人力資源部為專責單位，辦理本作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，並每季向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督查核情形。	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		本公司訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」中明訂利益衝突之相關政策，並鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為。本公司「董事會議事規範」，明訂董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，不得加入討論及表決，並不得代理其他董事行使表決權。	無重大差異
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	V		已建立有效之會計制度、內部控制制度等內部規章，為確保內部控制制度之遵行，內部稽核人員定期或不定期辦理查核督導各單位辦理自行評估作業。	無重大差異
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		本公司 113 年度透過公司內部 LMS 系統辦理誠信經營之教育訓練一次，並做隨堂測驗驗收學習成效。	無重大差異
三、公司檢舉制度之運作情形				
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？			本公司「工作規則」制定獎懲與檢舉制度，由人資部門專責處理相關事務，若發現或接獲檢舉，應立即查明事實，以維護公司權益。若有違反情事，依公司辦法規章辦理懲處。	無重大差異
(二) 公司是否訂定受理檢舉	V		本公司由人資單位處理相關	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ (三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		事務，並依規定之流程辦理。  本公司對檢舉人負保密責任且採行適當保護措施。	無重大差異
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		已依規定揭露於本公司企業網站本守則。	無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無重大差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 本公司將隨著相關法令規範以及整體社會之發展，並鼓勵董事、經理人及受僱人提出建議，據以檢討改進本公司誠信經營之成效。本公司之「誠信經營守則」，請參閱公開資訊觀測站或本公司企業網站查詢相關資訊。				

(七)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊

本公司持續加強公司治理運作，並即時於公開資訊觀測站揭露公告重大訊息以及公司治理資訊。

(八)內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書：請參閱公開資訊觀測站，【網址：<https://mops.twse.com.tw> > 單一公司 > 公司治理 > 公司規章 > 內部控制 / 內控聲明書公告】，輸入年度及公司代號，查詢內控聲明書公告。
2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1. 股東會

開會日期	重要決議內容
113年6月26日 113年度股東常會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認112年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 承認112年度盈餘分派案。</li> <li>3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。</li> <li>4. 制定「監察人之職權範疇規則」案。</li> <li>5. 全面改選董事及監察人案。</li> <li>6. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。</li> </ol>
113年11月20日 113年第一次股東臨會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。</li> <li>2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</li> <li>3. 本公司擬規劃申請股票上市（櫃）案。</li> <li>4. 補選監察人一席案。</li> </ol>

2. 董事會

開會日期	重要決議內容
113年3月28日 113年第一次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司113年度預算案。</li> <li>2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。</li> <li>3. 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。</li> <li>4. 制定「監察人之職權範疇規則」。</li> <li>5. 訂定本公司「會計制度」。</li> <li>6. 訂定本公司「內部控制制度自行評估作業辦法」。</li> </ol>
113年5月9日 113年第二次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 全面改選董事及監察人案。</li> <li>2. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。</li> <li>3. 訂定本公司113年召開股東常會相關事宜案。</li> <li>4. 本公司113年股東常會股東提案權之相關事宜。</li> </ol>
113年5月24日 113年第三次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國112年度營業報告書及財務報表承認案。</li> <li>2. 本公司112年度盈餘分配案。</li> <li>3. 112年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。</li> <li>4. 擬修訂本公司「行政核決權限表」案。</li> </ol>
113年7月5日 113年第四次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選舉董事長案。</li> <li>2. 本公司辦理113年現金增資發行新股案。</li> <li>3. 修訂本公司「內部控制制度」之部分內容案。</li> <li>4. 訂定「企業永續發展實務守則」案。</li> <li>5. 訂定本公司「誠信經營守則」案。</li> <li>6. 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。</li> <li>7. 訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。</li> </ol>

開會日期	重要決議內容
113年10月3日 113年第五次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認本公司 112 年度合併與個體財務報表案。</li> <li>2. 承認本公司 113 年第二季財務報表案。</li> <li>3. 113 年 1 月 1 日至 113 年 6 月 30 日內部控制制度有效性考核及聲明書案。</li> <li>4. 擬辦理股票申請登錄興櫃併同簡易公開發行案。</li> <li>5. 擬為全體董事監察人及經理人投保「董監事及經理人責任保險」。</li> <li>6. 為本公司股票公開發行之準備所需，訂定本公司相關作業辦法。</li> <li>7. 修訂本公司相關作業辦法。</li> <li>8. 本公司設置薪資報酬委員會及第一屆薪資報酬委員會委員委任案。</li> <li>9. 本公司指派發言人及代理發言人案。</li> </ol>
113年10月21日 113年第六次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司擬規畫申請股票上市（櫃）案。</li> <li>2. 補選監察人一席案。</li> <li>3. 113 年第一次股東臨時會召開時間地點及召集事由之相關事宜案。</li> </ol>
113年12月3日 113年第七次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 113 年 4 月 1 日至 113 年 9 月 30 日內部控制制度有效性考核及聲明書案。</li> <li>2. 永豐商業銀行融資綜合額度續約案。</li> <li>3. 兆豐國際商業銀行融資綜合額度申請案。</li> </ol>
113年12月5日 113年第八次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司薪資報酬委員會委員委任案。</li> </ol>
113年12月27日 113年第九次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 114 年度預算案。</li> <li>2. 本公司 114 年度稽核計畫案。</li> <li>3. 本公司 114 年度簽證會計師委任及報酬案。</li> <li>4. 本公司經理人派任案。</li> <li>5. 申請銀行授信額度案。</li> </ol>
114年3月5日 114年第一次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司「董事會績效評估辦法」案。</li> <li>2. 本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。</li> <li>3. 本公司「審計委員會組織規程」案。</li> <li>4. 擬授權本公司李秋燕董事簽核本公司稽核報告案。</li> <li>5. 擬向中國信託銀行申請融資綜合額度案。</li> <li>6. 擬定本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。</li> <li>7. 擬於上櫃前對外公開承銷辦理現金增資發行新股，並提請原股東全數放棄優先認購權利案。</li> <li>8. 全面改選董事(含獨立董事)案。</li> <li>9. 訂定本公司 114 年股東常會之日期、地點及召集事由案。</li> <li>10. 本公司 114 年股東常會受理股東提案權之相關事宜案。</li> <li>11. 本公司 114 年股東常會受理股東之提名是否列入候選人名單之相關事宜案。</li> </ol>

開會日期	重要決議內容
114年4月9日 114年第二次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成自行編製財務報告能力案。</li> <li>2. 113年營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。</li> <li>3. 員工酬勞及董監事酬勞提撥案。</li> <li>4. 本公司113年度盈餘分配案。</li> <li>5. 資本公積發放現金股利案。</li> <li>6. 本公司「公司章程」部分條文修訂案。</li> <li>7. 修訂「股東會議事規則」案。</li> <li>8. 修訂「董事及監察人選任程序」案。</li> <li>9. 本公司管理辦法修訂案。</li> <li>10. 本公司管理辦法制定案。</li> <li>11. 本公司113年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書案。</li> <li>12. 董事會提名董事及獨立董事候選人名單暨審查案。</li> <li>13. 解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。</li> <li>14. 本公司公司治理主管任命案。</li> <li>15. 修訂本公司114年召開股東常會相關事宜案。</li> </ol>

(十)最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

#### 四、簽證會計師公費資訊

單位：新台幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計
勤業眾信聯合會計師事務所	葉東輝	113. 1. 1 ~	1,499	1,862	3,361
	溫智源	113. 12. 31			

(一) 應揭露給付簽證會計師與其所屬事務所及關係企業之審計公費與非審計公費之金額及非審計服務內容：非審計公費 1,862 千元係指包含 113 年稅務簽證 206 千元、內控專審 1,226 千元、公開發行送件 300 千元、輔導服務費 130 千元。

(二) 有下列情事之一，應揭露下列事項

1. 更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無此情形。
2. 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。

五、更換會計師資訊：無此情形。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無此情形。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一) 股權變動及質押變動情形

單位：股

職稱	姓名	113 年度		114 年 截至 3 月 25 日止	
		持有股數增 (減)數	質押股數增 (減)數	持有股數增 (減)數	質押股數增 (減)數
董事長/大股東	捷創集成 股份有限公司	353,408	-	-	-
董事長之法人 代表/大股東	林益民	40,000	-	-	-
董事/副總經理	溫在昇	30,000	-	-	-
法人董事	迅英投資 有限公司	96,000	-	-	-
董事之法人代 表/副總經理	胡嘉禎	30,000	-	-	-
董事	李秋燕(註 1)	-	-	-	-
董事/副總經理/ 財務部門主管/ 會計部門主管	鄭文吉(註 1)	40,000	-	9,000	-
監察人	梁立恆(註 1)	30,000	-	-	-
法人監察人	傳晶投資 有限公司(註 2)	(278,000)	-	-	-
法人監察人代 表	俞思瑩(註 2)	-	-	-	-
監察人	廖瑞萍(註 3)	-	-	6,000	-
副總經理	柯鴻毅	50,000	-	-	-

註 1：於 113 年 6 月 26 日新任。

註 2：於 113 年 11 月 19 日解任。

註 3：於 113 年 11 月 20 日新任。

(二) 股權移轉之相對人為關係人者之資訊

114 年 3 月 25 日；單位：股

姓名	股權移轉 原因	交易日期	交易相對 人	交易相對人與公司、董事、 監察人、經理人及持股比例 超過百分之十股東之關係	股數	交易 價格
傳晶投資有限公司	處分	113.07.08	林則炆	董事長二等親以內之親屬	200,000	30
傳晶投資有限公司	處分	113.07.08	林則均	董事長二等親以內之親屬	200,000	30

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

114年3月25日；單位：股；%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
捷創集成股份有限公司	4,301,567	23.90	-	-	-	-	林益民	董事長	-
傳晶投資有限公司	1,710,248	9.5	-	-	-	-	林益民	董事	-
迅英投資有限公司	1,347,111	7.48	-	-	-	-	胡嘉禎	董事	-
華谷投資有限公司	1,140,200	6.33	-	-	-	-	-	-	-
華峪投資有限公司	1,042,300	5.79	-	-	-	-	-	-	-
永豐金證券股份有限公司	857,154	4.76	-	-	-	-	-	-	-
林益民	412,955	2.29	-	-	1,710,248	9.50	捷創集成股份有限公司	董事長	-
							傳晶投資有限公司	董事	-
泉銷投資有限公司	367,500	2.04	-	-	-	-	-	-	-
威柏投資有限公司	245,000	1.36	-	-	-	-	-	-	-
胡嘉禎	242,125	1.35	-	-	1,347,111	7.48	迅英投資有限公司	董事	-

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

113年12月31日止；單位：股；%

被投資公司名稱	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接轉投資事業或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	比率	股數	比率	股數	比率
Jtron (SAP) Pte. Ltd	120,000	29.34%	-	-	120,000	29.34%
捷創微精量測股份有限公司	501,400	39.17%	-	-	501,400	39.17%
捷覈科技股份有限公司	244,125	35.00%	-	-	244,125	35.00%
Hanbit-Jtron Co., Ltd.	12,000	40.00%	-	-	12,000	40.00%
寰鼎集成電路(上海)有限公司	-	21.33%	-	-	-	21.33%

註：係公司採用權益法之投資。

參、募資情形

一、資本與股份

(一)股本來源

1. 股本形成(截至年報刊印日止之最近年度資料)

年月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數(千股)	金額(千元)	股數(千股)	金額(千元)	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
107.12	25	20,000	200,000	10,000	100,000	現金增資11,200千元	無	註1
112.07	-	30,000	300,000	10,000	100,000	增加核定股本10,000千股	無	註2
112.08	-	30,000	300,000	11,000	110,000	盈餘轉增資10,000千元	無	註3
113.01	30	30,000	300,000	14,000	140,000	現金增資30,000千元	無	註4
113.09	50	30,000	300,000	18,000	180,000	現金增資40,000千元	無	註5

註1：107.12.21 經授中字第10733763990號。

註2：112.07.20 經授中字第11233426820號。

註3：112.08.30 經授中字第11233530570號。

註4：113.01.15 經授商字第11330338350號。

註5：113.09.02 經授商字第11330788090號。

2. 已發行股份種類(截至年報刊印日止之當年度資料)

股份種類	核定股本(千股)			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
記名普通股	18,000	12,000	30,000	-

3. 總括申報制度資訊：不適用。

## (二)主要股東名單

114年3月25日；單位：股；%

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
捷創集成股份有限公司		4,301,567	23.90%
傳晶投資有限公司		1,710,248	9.50%
迅英投資有限公司		1,347,111	7.48%
華谷投資有限公司		1,140,200	6.33%
華峪投資有限公司		1,042,300	5.79%
永豐金證券股份有限公司		857,154	4.76%
林益民		412,955	2.29%
泉銷投資有限公司		367,500	2.04%
威柏投資有限公司		245,000	1.36%
胡嘉禎		242,125	1.35%

## (三)公司股利政策及執行狀況

### 1. 公司章程所訂之股利政策：

本公司章程第十七條規定，本公司每年決算如有盈餘，除依法繳納所得稅及彌補以往年度虧損外，次提百分之十為法定盈餘公積，其餘由董事會視營運需要，擬案提請股東會同意酌予保留適當額度後再分派之。但法定盈餘公積以達實收資本總額時，不在此限，其餘依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積後，如尚有餘額，由董事會視營運需要保留適當額度後，擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分配股東股利。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外經濟與競爭狀況，於兼顧股東利益等因素，每年就可分配盈餘不低於百分之二十提撥股東股息紅利，得以現金或股票方式為之，惟現金股利不低於股利總額百分之十；然因本公司有重大投資計畫且無法取得其他資金支應時，經董事會擬具及股東會決議得不發放現金股利。

### 2. 股東會擬議股利分派之情形：

本公司董事會於民國114年4月9日決議分派113年度股東現金股利新台幣63,000千元，每股配發現金3.5元，另以超過面額發行普通股溢價之資本公積新台幣9,000千元，每股配發現金0.5元。俟本次股東會決議後，擬提請股東會授權董事長訂定發放基準日，並依該日流通在外股數計算調整分配之。

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

## (五)員工、董事及監察人酬勞

### 1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

本公司章程第十六條之一規定，公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放。本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之三為董監酬勞，董監酬勞以現金發放。但公司尚

有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞得以現金或股票為之，其分派對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一條件由董事會訂定之。

2. 本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額，若與估列數有差異時之會計處理：

本公司依公司章程所定之成數估列員工、董事及監察人酬勞金額，實際配發金額與估列金額有差異時，則依會計估計變動處理，於董事會決議年度調整入帳。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

- (1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異，應揭露差異數、原因及處理情形：

本公司 113 年度員工酬勞與董監酬勞分配案，業經 114 年 4 月 9 日董事會決議通過，配發董事及監察人酬勞計 2,035 千元，員工酬勞計 12,211 千元，上述金額皆以現金方式配發，且與年度估列金額無差異。

- (2)以股票分派之員工酬勞金額占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無此情形。

4. 前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形(包括配發股數、金額及股價)其與認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：無此情形。

(六)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：本公司無發行公司債。

三、特別股辦理情形：本公司無發行特別股。

四、海外存託憑證辦理情形：本公司無發行海外存託憑證。

五、員工認股權憑證辦理情形：本公司無發行員工認股權憑證。

六、限制員工權利新股辦理情形：本公司無發行限制員工權利新股。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：本公司無併購或受讓他公司股份發行新股。

八、資金運用計畫執行情形

- (一)截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者：無。

- (二)截至年報刊印日之前一季止，本公司前各次發行之有價證券資金運用計畫皆已完成。

## 肆、營運概況

### 一、業務內容

#### (一)業務範圍

##### 1. 本公司 113 年度所營業務主要內容及其營業比重：

所營業務主要內容	營業比重
設備工程技術服務與維修	83.30%
代理與自有產品銷售	16.70%
合計	100.00%

##### 2. 本公司目前之產品(服務)項目

###### (1)設備工程技術服務與維修

本公司目前服務主要範圍為半導體測試機台及週邊設備，因與原廠共同合作，透過有系統與專業訓練之服務工程師及累積多年的設備工程技術服務經驗所自行開發的「工程服務管理資訊系統」JESSICA (Jtron Electronic Service and Support Integrated Call Administration system) 系統，提供本公司與原廠有關於其銷售設備相關工程服務所有的功能，藉由系統化的方式可降低人力及作業錯誤率，提升整體服務效率及品質，從服務需求提出到結案資料分析，皆可透過本公司 JESSICA 系統進行完整管理及保存。

本公司銷售與服務方式包含：系統銷售、維護、系統安裝、設定、移機、校驗、維修、到廠服務、系統程式開發及客製化支援與系統整合服務工作站升級、教育訓練與電路板、電源供應器、零件維修及買賣，整合設備生命週期一條龍服務。

###### (2)代理與自有產品銷售

###### A. 自有產品

本公司擁有完整的研發團隊，服務項目涵蓋由軟體開發到硬體的設計及改善等方面。由於本公司為世界級半導體測試機台原廠所認證的合格服務團隊，長期與原廠的合作使本公司累積測試機台硬體與軟體之相關經驗，能提供與協助客戶相關生產與製程改善與建議。據此發展出兩大類之自有產品：

###### (A)測試單元(TEST CELL)相關之硬體與治具

除測試機及測試方式之開發外，本公司依照客戶需求設計機台對接硬體設備，包含機台支撐架/手臂、生產用治具 JIG、韌體/軟體開發等基礎硬體設備到機台端的改善及相關機台儀器開發出對應之產品。

###### (B)自動化整合平台-Jtron Embedded Edge Platform

本公司之產品 Jtron Embedded Edge Platform，能依據客戶的不同需求，在不入侵/改造/破壞設備之條件下，可以協助客戶達成下列三項目標：

a. 收集機台及環境參數：

透過各式感知器、各式通訊埠及時收集機台生產及環境之類比與數位資訊，並轉換成業界通用之通訊協定如 TCP/IP、SECS GEN 或 E84，以連結相關之生產管理系統如 MES 或 ERP。

b. 遠端監控與智能控管：

透過邊際運算的技術，及減少人員介入與進出工廠的狀況下，及時監控/查詢機台生產資訊與生產環境狀況，進而智能掌控機台進行量產，並對於機台異常前，提出警告訊息，並即時反應、自動處置機台之異狀。

c. 整合資訊、單一溝通：

在生產流程中，整合產線中各種設備平台資訊、界面，提供整合後的資訊及單一溝通界面進行多種設備平台的溝通。

B. 代理產品

捷創在提供客戶維修服務的同時，也發現客戶在工程上的需求，故捷創也代理了 Advantest EVA100 測試機、Galaxy Examiner、Cupola 360 等公司產品，以滿足客戶測試、工程分析與工廠管理的需求。

3. 本公司計畫開發之新產品(服務)

本公司在原有工程技術服務之基礎上，積極開發智慧工廠與智慧實驗室 (Smart Manufacturing and Smart Lab.)，透過本公司 Jtron Embedded Edge Platform 產品之運用，讓傳統的自動化設備由人與機器間之控制介面，進化到機器對機器間之溝通、自動協作並取代原來需要有作業員在現場執行工作，達到 Smart Manufacturing，增加生產效能與效率，實現關燈工廠的目標。

此外，近年實驗室常受到人力之限制，而導致檢測能量不足，透過本公司 Jtron Embedded Edge Platform 產品與機器手臂及 RPA(Robotic Process Automation，軟體機器人)的協作下，可以將實驗室中彷彿孤島存在的儀器設備與其他儀器、機器手臂等作溝通與連結，在最少人力的介入下，自動開關機、自動待機暖機、自動開啟應用程式、輸入相關資訊、拿取樣本檢測、完成檢測報告等工作，將可以有效提升檢驗能量，減少人力的限制因素。

(二) 產業概況

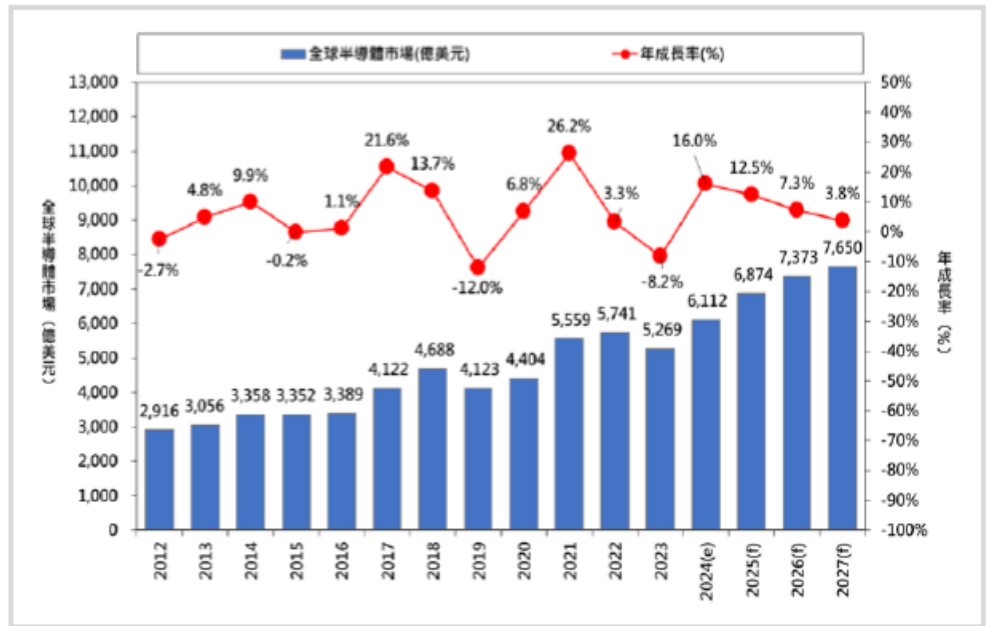
1. 產業現況與發展

A. 全球半導體產值狀況

根據世界半導體貿易統計組織(WSTS)統計，隨著全球通膨趨緩、終端市場需求回溫，半導體產業進入景氣復甦階段，再加上人工智慧、高效能運算等新興應用需求熱絡，預估 2024 年全球半導體市

場規模達 6,112 億美元，較 2023 年成長 16.0%，顯示出全球半導體市場總產值穩步增長的趨勢。展望 2025 年，隨著終端市場需求回升，全球半導體市場預計將持續增長，總銷售額預計將達到 6,874 億美元，年增長率為 12.5%。儘管半導體市場增長率受多種因素影響而有所波動，惟市場總體規模不斷擴大，顯示出長期增長的潛力和韌性。

全球半導體市場年度成長趨勢預測



註：數據源自於 WSTS 於 2024 年 06 月發布之全球半導體市場預測數據  
資料來源：工研院產科國際所

### B. 台灣半導體產值狀況

根據台灣半導體產業協會(TSIA)的預估，2024 年台灣 IC 產業產值將達到約 5 兆 116 億元，年增長率達 15.4%，超越全球半導體業的年增長率 13.1%。其中，台灣 IC 設計業產值約為 1 兆 2,570 億元，年增長 14.6%；IC 製造業產值為 3 兆 1,038 億元，年增長 16.6%；晶圓代工產值為 2 兆 9,060 億元，年增長 16.6%；記憶體與其他製造產值為 1,978 億元，年增長 16.3%；IC 封裝業產值為 4,362 億元，年增長 11%；IC 測試業產值為 2,146 億元，年增長 12.6%。

台灣 IC 設計業在 2020 年至 2021 年間經歷了快速增長，隨後增長速度有所放緩。回顧 2023 年，由於高通膨和升息等總體經濟不利因素，上半年消費市場需求疲弱，通路商持續調節庫存，出貨

量下修，市場衰退幅度顯著。然而，隨著下半年庫存回穩和市場需求回溫，自 2023 年第三季起，各大主要半導體市場數據漸趨樂觀，並預計 2024 年將有所回升。

整體而言，IC 設計業依然是具潛力的領域，但其增長可能會受到市場波動和外部因素的影響。未來的增長將取決於技術創新、市場需求和全球半導體市場的動態。根據台灣半導體產業協會 (TSIA) 於 2024 年 2 月公布的數據，2023 年台灣 IC 產業產值約為 4.34 兆元，年減 10.2%，衰退幅度高於全球半導體市場的 8.2%。然而，2024 年市場預估值上調至成長 13.1%。

## 2020 ~ 2024 年台灣 IC 產業產值

億新臺幣	2020	2020 成長率	2021	2021 成長率	2022	2022 成長率	2023	2023 成長率	2024(e)	2024(e) 成長率
IC 產業產值	32,222	20.9%	40,820	26.7%	48,370	18.5%	43,428	-10.2%	50,116	15.4%
IC 設計業	8,529	23.1%	12,147	42.4%	12,320	1.4%	10,965	-11.0%	12,570	14.6%
IC 製造業	18,203	23.7%	22,289	22.4%	29,203	31.0%	26,626	-8.8%	31,038	16.6%
晶圓代工	16,297	2.1%	19,410	19.1%	26,847	38.3%	24,925	-7.2%	29,060	16.6%
記憶體與其他製造	1,906	19.4%	2,879	51.0%	2,356	-18.2%	1,701	-27.8%	1,978	16.3%
IC 封裝業	3,775	9.0%	4,354	15.3%	4,660	7.0%	3,931	-15.6%	4,362	11.0%
IC 測試業	1,715	11.1%	2,030	18.4%	2,187	7.7%	1,906	-12.8%	2,146	12.6%
IC 產品產值	10,435	22.4%	15,026	44.0%	14,676	-2.3%	12,666	-10.2%	14,548	14.9%
全球半導體市場(億美元)及成長率(%)	4,404	6.8%	5,559	26.2%	5,741	3.3%	5,268	-8.2%	5,958	13.1%

資料來源：TSIA；工研院產科國際所

### C. 半導體設備市場狀況

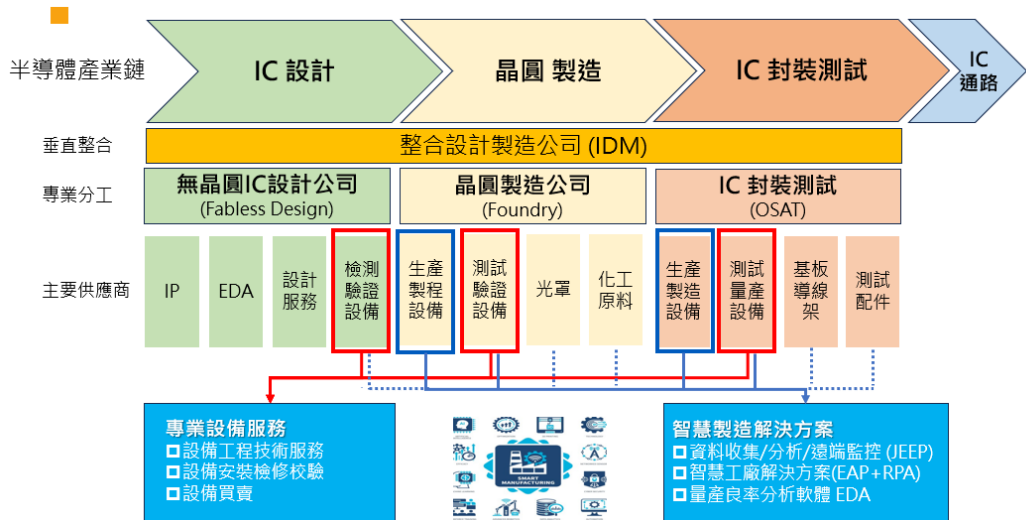
半導體製程主要分成前段製程及後段製程，半導體製程步驟可以粗分成微影、蝕刻、沉積、摻雜與平坦化等實際在晶圓上製造出電路的製程步驟，以及穿插在這些步驟之間的清洗製程，統稱為前段製程；後端製程包括封裝、測試以及包裝，過程有切割、黏晶、打線接合、成型和檢查。各個製程過程中都有各自使用的半導體設備，透過各種高度精密的儀器，以支援晶片製造過程。半導體設備應用範疇主要分為晶圓廠和邏輯應用、DRAM 及 NAND。而在半導體製程中，主要製造設備有光罩機、蝕刻機、薄膜設備、擴散/離子注入設備、濕式設備、檢測等六大設備。

依據國際半導體產業協會 (SEMI) 指出 2023 年全球半導體設備銷售總額達 1,063 億美元，僅衰退 1.3%，比半導體市場衰退 9.4% 來得輕微，在前後段製程推動下，預期 2024 年小幅回升，並在 2025 年創下 1,240 億美元新高點。半導體設備採購一直是廠商資本支出的最大宗項目，以 2023 年為例，半導體設備占資本支出的 67%。其中，在半導體設備市場裡占比最大的是晶圓代工和邏輯製程設備，

預計 2025 年在新一輪產能擴張及新製程技術導入，會有不錯的成長力道。記憶體設備方面，包含 HBM3E、DDR5、3D NAND 等產能陸續展開，預期 2025 年有高成長率表現。預計 2025 年封測設備也有雙位數成長率。

## 2. 產業上中下游之關聯性

本公司主要從事半導體製程設備與檢測設備相關之工程技術服務、維修、設備代理、自製設備之買賣與本公司 Smart Manufacturing 及 Smart Lab. 等系統整合服務等，屬半導體產業之中、下游。



半導體產業主要上、中、下游之關聯及產業定義：

上游：包括 IP 設計、IC 設計及代理服務，主要進行積體電路的研發設計及佈局圖製作。

中游：涉及 IC/晶圓製造，涵蓋生產製程及檢測設備、光罩、化學品等。

下游：包括 IC 封裝測試及模組製作，涉及生產製程及檢測設備、基板、導線架等，以及 IC 通路管理。

本公司產品與服務主要用於為 IC/晶圓製造及 IC 封裝測試，貫穿於半導體生產製造流程。

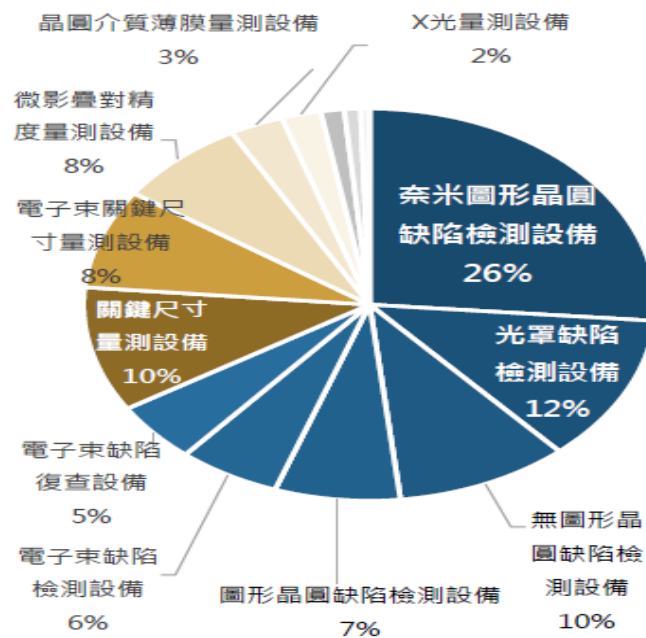
## 3. 產品之各種發展趨勢與競爭情形

### A. 產品發展趨勢

半導體設備市場歷經多年歷史性榮景，2023 年出現循環性調整總銷售額下滑，市場預估 2024 年市場可望回溫，同時預估 2025 年受惠於新晶圓廠成立、產能擴張、以及先進技術和解決方案需求看漲的利基下，將迎來強勁反彈，帶動前段和後段製程設備需求成長。依據國際半導體產業協會 (SEMI) 於 2024 年 9 月發布最新報告，預測 2025 年至 2027 年間全球半導

體製造商將大幅增加對半導體製造設備的支出，預計總額將達創紀錄的4,000億美元(約新台幣12兆元)，其中以中國、韓國與台灣為主要資本支出之地區。

隨著5G、人工智慧(AI)、物聯網(IoT)、電動車(EV)等應用領域的快速發展，對高性能和高可靠性的IC需求增加，進一步推動了測試設備的市場需求。先進製程(如7nm、5nm、3nm)的發展，使得IC更加複雜，測試需求也隨之增長。此外由人工智慧(AI)、高效能運算(HPC)晶片帶動先進封裝2.5D/3D相關設備需求增加，而對於先進封裝，其測試趨複雜，難度也提高，需有各個功能之測試設備來支持先進封裝、測試的發展，此部分對生產高階測試設備的廠商是為有利的商機。台灣IC封測業者面臨技術升級，有鑑於未來先進封裝的比重會越來越高，現有的產能並不足夠，所以需要長期採購機台來滿足需求，致力發展更高效能封裝技術，因此也仰賴封測設備的技術提升。



資料來源：SEMI、工研院產科國際所整理；2024/7

本公司目前主要產品(服務)範圍為測試設備，伴隨著原廠愛德萬測試(Advantest)、是德科技(Keysight)等公司之設備技術提升，本公司亦須提升自身技術，以協助原廠進行產品服務。本公司擁有完整及堅強的技術、服務團隊，透過持續不斷地增進服務技術，搭配自行開發之工程服務管理資訊系統 JESSICA 系統，同時除服務原廠設備之外，對於終端客戶於製程中，為提高生產良率、減少人力、提高自動化、生產管理系統與設備間之溝通等需求，本公司亦與終端客戶共同開發解決方案，故本公司應可持續在半導體設備服務市場取得技術及產品的領先地位。

## B. 市場競爭情形

半導體設備泛指用於生產各類半導體產品所需的生產設備，屬於半導體行業產業鏈的關鍵支撐環節。半導體設備是半導體產業的技術先導者，

IC 設計、晶圓製造和封裝測試等需在設備技術允許的範圍內設計和製造，設備的技術進步又反過來推動半導體產業的發展。半導體封裝是利用薄膜細微加工等技術將晶圓在基板上佈局、固定及連接，並用可塑性隔緣介質灌封後，形成 IC 電子產品的過程，目的是保護晶圓免於損壞，保證晶圓的散熱性能，以及實現電能和電信號的傳輸，確保系統正常工作，而半導體測試主要是對晶圓外觀、性能等進行檢測，目的是確保產品品質。半導體封裝及測試是半導體製造流程中重要的收尾工作，同時隨著晶圓製造越來越先進、成本越來越高，晶圓製造廠商亦須於相關製程階段中進行 IC 產品測試，降低最終產出之晶圓損失。

半導體測試產業的特性在於高比重的固定成本，一台測試機台動輒上億元，常常是影響測試廠商獲利甚至是存續與否的關鍵，而每年的設備折舊費用通常佔了直接成本的 50%以上，因此測試機台的使用狀況對半導體測試產業相當重要，更顯示測試設備商提供產品售後服務之重要性。半導體設備商在銷售設備給客戶時，除了自己進行設備相關服務之外，亦委外由專業廠商進行服務，惟客戶眾多、所在地分布較廣，原廠於人力配置上，相較喜愛委由專業服務團隊進行。

本公司在設備工程技術服務業務上已成為客戶供應鏈之重要一環，特別是本公司為半導體設備的前十大廠商之主要工程服務提供商，及在設備延壽服務與銷售上，取得來自於原廠的全球單獨授權，提供全球主要半導體製造商原廠除役測試設備之部件更換與維修服務。此外，本公司自行開發之「工程服務管理資訊系統(JESSICA)」之使用，進行派工與案件管理，協助原廠進行諸如裝機、移機、維修、校驗、升級等服務，使本公司在半導體測試製程設備之技術工程服務上，取得競爭優勢。

此外，本公司之自動化整合平台產品 Jtron Embedded Edge Platform，有別於其他競爭對手需要針對需整合設備之 I/O 介面、通訊協定去個別尋找解決之硬軟體，本公司之產品則提供完整具平台式管理、OTA 升級、豐富的 I/O 介面、通訊協定及可以提供客製化的設計之解決方案，使客戶無需為個別硬體之後續維護升級等事項投入過多資源。

### (三)技術及研發概況

#### 1. 最近年度及截至年報刊印日止，投入之研發費用

年度	113 年度	114 年 3 月 31 日止 自結資訊
研發費用(仟元)	34,965	7,741
營業收入淨額(仟元)	441,720	123,715
研發費用比例	7.92%	6.26%

2. 最近年度及截至年報刊印日止，開發成功之技術或產品
  - 光刻機智能遠端控制系統
  - 93K MMCC Clamper
  - 93K EXA-Scale serial Clamper
  - Jtron Embedded Edge Platform

(四)長、短期業務發展計畫

本公司初期業務發展係以設備技術工程服務為主，隨著半導體產業的發展，逐漸發展設備延壽服務與銷售、設備儀器之維修服務，也擴展到為所提供服務客戶之設備周邊之軟、硬體之整合與改良等業務，下一階段的目標則是以自有品牌，提供 Smart Manufacturing/Smart Lab. 全方面的解決方案。

1. 短期發展計畫

A. 持續擴展設備技術工程服務業務

除配合現有客戶產品發展提供必要之技術工程能量外，並開發來自於設備使用之終端客戶或其他半導體設備廠之設備技術服務，促進本公司產品服務範圍增加與長期產品規劃，提供更完整的全方案產品服務，成為設備使用者的最佳設備服務伙伴。

B. 拓展設備延壽服務

與本公司配合之半導體設備原廠設備陸續有除役的計畫，統合本公司接手來自於原廠的設備、部件、維修手法等能量，並拓展全球之延壽設備之年度維護合約、部件維修、校驗與買賣的業務。

C. 推廣自有產品

自有產品之推廣，不同於前兩項之業務進行方式，需要進行充分的市場調查、競爭分析、與客戶關係經營，故除了持續的產品研究開發外，布建足夠的業務能量，逐步擴大市場之滲透率，提供服務客戶之設備周邊之軟、硬體之整合與改良等業務，提供完整的技術支援和客製化整合服務，提升客戶滿意度。

2. 長期業務發展計畫

A. 智能設備技術工程服務業務

設備技術工程服務之成長也伴隨著人力增加的需求，惟在少子化的衝擊下，勢必也會影響本公司技術工程服務之能量。據此，本公司思考如何將 Jtron Embedded Edge Platform 產品之特性與技術工程服務之需求，透過 Jtron Embedded Edge Platform 遠端監控與智能控管等功能，來提升設備技術工程服務之效能。

B. 自有產品之跨領域應用及拓展海外市場

本公司自有產品主要圍繞在半導體產業，目前有關於工廠自動化、智能化與遠端控制的需求也多半來自於半導體產業。惟其他產業因少子化的影響，對於 Smart Manufacturing 及 Smart Lab. 之需求也不亞於半導體

產業，故透過跨領域應用之業務開發，公司可以分散風險，增加新的業務機會。

此外隨著半導體產業之區域化分散化之趨勢，透過本公司之轉投資公司、代理商、或本公司主要客戶之海外工廠需求等，來推展海外之市場。

### C. 推動國際合作與併購策略

為了更有效率之經營與取得更多的技術與市場份額，本公司將尋求可能的合作與購併之機會。

## 二、市場及產銷概況

### (一) 市場分析

#### 1. 主要產品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新台幣千元

地區		年度	112 年度		113 年度	
			銷貨金額	%	銷貨金額	%
內銷			285,712	78%	359,682	81%
外銷	亞洲		60,595	17%	64,182	15%
	美洲		14,614	4%	15,400	3%
	歐洲		4,685	1%	2,456	1%
	小計		79,894	22%	82,038	19%
合計			365,606	100%	441,720	100%

#### 2. 市場占有率

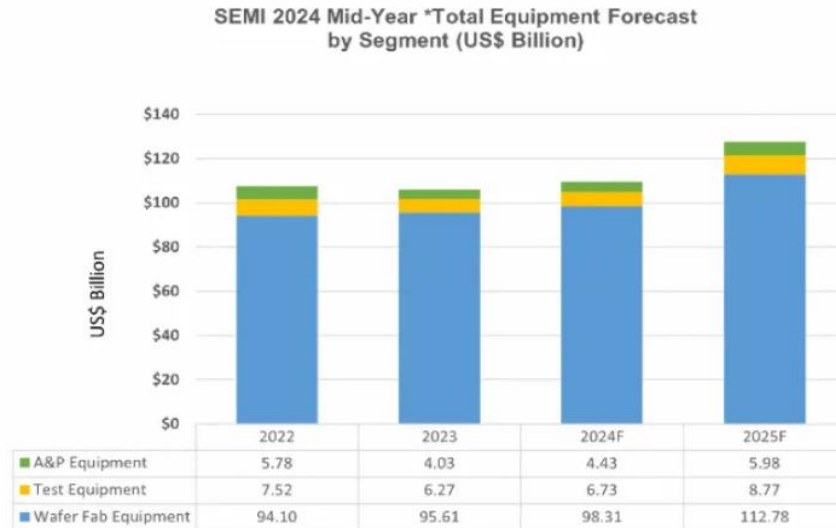
依據 2024 年 7 月國際半導體產業協會(SEMI)最新「年中整體 OEM 半導體設備預測報告」顯示，半導體測試設備 2024 年之銷售金額計 67.3 億美元，由於本公司主要銷售產品與工程技術服務皆與半導體測試設備有關，依本公司 113 年度營收約為 441,720 千元推算，得出本公司於半導體測試設備之銷售占有率約為 0.2%，雖比重不大，惟本公司合作之主要半導體設備原廠為全球前十大半導體設備公司之一，台灣區域為該半導體設備原廠主要銷售地點，2024 會計年度對台灣銷售之金額已達該半導體設備原廠銷售額之 40% 以上，顯示本公司已為設備原廠重要之合作夥伴。

#### 3. 市場未來供需狀況與成長性

本公司銷售與服務之市場未來需求及成長在於半導體產業未來發展，而半導體產業是全球經濟的重要組成部分，在許多領域都扮演著關鍵角色，包括資訊科技、5G 通訊、人工智慧、工業、汽車、醫療保健等。隨著全球經濟的持續成長，半導體產業也將保持強勁的成長趨勢，半導體製造技術的持續向前進步，故半導體設備亦伴隨著半導體產業的成長而成長。

半導體設備銷售主要分為晶圓廠設備、測試設備和封裝設備三個部分。晶圓廠設備包括晶圓生產、製造設施和光罩設備。依據 2024 年 7 月國際半

導體產業協會(SEMI)最新「年中整體 OEM 半導體設備預測報告」指出，2024 年晶圓廠設備的銷售額將成長 2.82%至 983 億美元，2024 年封測廠設備的銷售額將成長 7.34%至 67.3 億美元。整體全球半導體製造設備市場持續暢旺，預估 2024 年銷售總額可望達到 1,094.7 億美元，年成長 3.36%，2025 年更預估有機會成長至 1,275.3 億美元，比 2024 年更加向上攀升。



資料來源：SEMI Equipment Market Data Subscription (EMDS)；2024/7

#### 4. 競爭利基

##### A. 與國際半導體設備大廠的合作關係

本公司與 Advantest、Keysight、Agilent 等著名國際半導體設備廠有長年的合作關係，隨著半導體先進製程與產品技術領域的應用，此等半導體設備廠於半導體產業之重要性將與日俱增，也是本公司業務穩定成長之來源。

##### B. 卓越的工程技術服務系統與經驗

本公司為專業之工程技術服務公司，在”成為世界級科技產業的設備服務夥伴與解決方案供應商”的願景下，一步一步實現中，透過本公司完善的 JESSICA 派工系統，及完整的服務工程師的訓練制度，除持續隨著現有客戶成長外，亦可以提供半導體產業其他有工程技術服務需求的公司有效率之服務。

##### C. 擁有配合客戶發展之研究開發團隊

本公司因擁有多年的半導體設備原廠工程技術服務經驗，也實際接觸到設備之使用者。鑒於半導體產業激烈之競爭，各家對於生產效率與提高生產良率、無人化自動化等提高營運效率、降低成本之議題無不卯足全力發展。本公司藉由工程技術服務累積的經驗，建立了一個具有軟硬體開發能力之研究開發團隊，提供原廠及終端設備使用者有關於製程改進與自動化、智慧化的各項解決方案，包含軟韌體、治具、IoT 與設備自動化整合方案等解決方案。

## 5. 發展遠景之有利及不利因素與因應對策

### A. 有利因素

#### (A) 半導體產業持續快速發展、需求強勁

半導體產業持續快速發展，在智慧型手機和其他可穿戴設備等消費電子產品的普及、汽車和工業等其他垂直領域對半導體的需求增加、5G 和人工智能等新興技術的發展及半導體製造技術的進步等因素驅動下，需求強勁，目前國內外半導體廠持續因應銷售需求進行擴張，預計半導體設備之工程技術服務及維修市場將持續穩定之成長。

#### (B) 國際半導體設備大廠的供應鏈成員

本公司為全球主要半導體測試設備商之在台合作夥伴，此外也是測試設備之測試頭支撐架或機架等產品之 ODM 廠商，隨著半導體先進製程與產品技術領域的應用，此等半導體設備廠於半導體產業之重要性與銷售數量將與日俱增，也是本公司業務穩定成長之來源。

### B. 不利因素與因應對策

#### (A) 人才需求競爭激烈

本公司屬於人力密集之技術服務產業，技術人才的培養和訓練需要長時間的投入。隨著台灣半導體行業的蓬勃發展，相關技術人才成為各家半導體公司積極爭取的對象。由於技術服務人才的培養過程需要較長時間，且無法在短期內速成，因此在台灣人口數下降，科技人才爭奪激烈的情況下，持續面臨著潛在的風險，穩定且優秀的服務團隊是公司穩定經營的基礎，因此如何吸引優秀人才，將是本公司保持競爭力和長期穩定經營的關鍵挑戰。

#### 因應措施

本公司將加強產學合作及學生實習計畫，積極與學術界及鄰近大專院校合作，提供具競爭力薪酬及福利，塑造良好的工作環境，讓員工樂於工作，並強化企業文化以及有效的人才招聘，吸引和保持優秀人才，同時持續優化本公司 JESSICA 派工系統，提高工作效率，並開發智能設備技術工程服務業務，透過 Jtron Embedded Edge Platform 遠端監控與智能控管等功能，來提升設備技術工程服務之效能，以提高本公司競爭力。

#### (B) 半導體景氣變動激烈

雖然目前預估全球對於半導體產業及相關之產品之需求強勁，惟由過去的經驗可知，景氣反轉時，其變動也是非常的激烈，因過於依賴單一產業，將使本公司營運風險增加。

#### 因應措施

本公司除與設備原廠維持緊密關係外，亦與下游設備使用客戶密切合作，提供長期穩定之合作關係，透過 JESSICA 派工系統確保本公司服務效率提升，

同時未免對於單一產業之過度依賴，以及人力不足所衍生的問題，故透過本公司 Smart Manufacturing 及 Smart Lab. 的解決方案，推廣到半導體產業以外的產業，將可以降低營運受到產業景氣變動的影響。

(C) 客戶集中之風險

本公司目前客戶集中於主要設備原廠，若設備原廠異動將對公司營運獲利產生不利影響。

因應措施

本公司除與目前原有設備原廠維持穩定合作之外，將持續開發終端設備使用廠商之設備服務，積極建立其他半導體設備原廠與使用廠商間之合作關係，促進產品多元性與長期產品規劃，有助於提前佈局未來服務產品架構，達成與設備原廠共同服務下游客戶之業務。另將透過自有產品開發及推廣至半導體以外之產業，培養不同合作方式，達到與客戶共同成長且分散客戶集中風險。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之用途

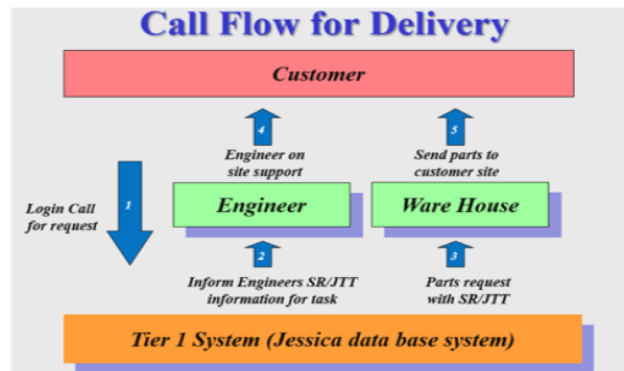
產品項目	重要用途及功能
設備技術工程服務與維修	提供客戶從裝機階段到穩定生產階段等期間之設備安裝、校驗、應用支援、良率提升、教育訓練、設備試產、移轉、定期維護保養、維修、軟硬體更新、整新等服務。
代理與自有產品	提供客戶維修服務的同時，也發現客戶在工程上的需求，故本公司也代理 Advantest、Galaxy、cupola360 等公司產品，同時研發自有治具、配件產品，開發出 Jtron Embedded Edge Platform 平台，滿足客戶測試、工程分析、系統整合的需求。

2. 產製過程

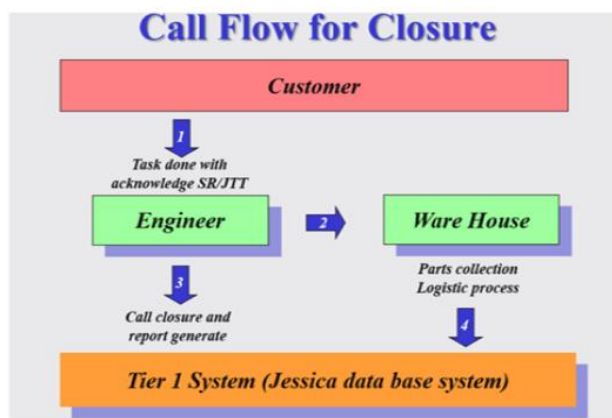
A. 設備技術工程服務

本公司設備技術工程服務流程主要分為：

(A)開案



(B)結案



B.設備延壽服務與設備儀器維修

設備延壽服務主要為延續設備原廠提供其客戶設備服務，於原廠設備服務清單上除役後，轉由本公司繼續提供原廠級的相關服務。主要服務內容為透過締結年度合約，提供更換部件、維護保修人力、及年度校驗服務三類。年度服務合約中載明年度可更換部件數、保修人工小時數、年度校驗次數等，於實際使用時，扣除額度。更換後之部品，則入到本公司壞品庫，等待修復整新後供下次部品更換之用。若未締結年度服務合約者，也提供單一部件的維修服務。

本公司設備儀器維修主要包含設備整新、半導體測試設備部件維修及儀器之維修，相關服務流程如下：



### C.代理與自有產品

#### (A)代理產品：

於接獲客戶訂單後，由本公司出貨客戶處進行安裝。

#### (B)自有產品：

依據產品之設計於採購相關之原材料，或設計好之圖檔後委由加工廠加工後，回到本公司庫房入庫，再由本公司同仁至客戶指定之地點進行安裝。

#### (三)主要原料之供應狀況

本公司以專業技術人員搭配設備各項部件，提供設備工程專業服務，向設備原廠購買部件或自行開發部件、維修舊部件等方式，為客戶提供服務，而為確保設備延壽服務所需部件能持續提供無虞，也與國際間著名之中古設備商保持緊密的聯繫與往來，藉以獲得可供使用之部件。而對本公司自有產品生產原物料包含了電子、機構料件及委外之製造廠或加工廠，採購與研發單位從多家經過供應商評估審查的廠商中取得相關之原物料，以確保品質和交貨穩定。

上述措施將有助於確保公司原物料供應充足，同時保持優良的品質及可靠的交貨期限，以支持本公司的營運順利運作。本公司始終以堅持高品質產品、專業服務和永續發展為目標，並積極與各供應商建立穩固的合作夥伴關係。

#### (四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因

##### 1. 最近二年度主要銷貨客戶

增減變動原因：

(1)丙公司係有本公司之自有產品需求。

單位：新臺幣千元；%

項目	112 年度				113 年年度			
	名稱	金額	占全年度 銷貨淨額 比例	與發行人 之關係	名稱	金額	占全年度 銷貨淨額 比例	與發行人 之關係
1	甲公司	182,849	50.01	無	甲公司	195,005	44.15	無
2	丙公司	33,645	9.20	無	丙公司	60,019	13.59	無
	其他	149,112	40.79		其他	186,696	42.26	
	銷貨淨額	365,606	100.00		銷貨淨額	441,720	100.00	

註 1: 已與客戶簽訂保密協定，故以代碼揭露。

2. 最近兩年度主要進貨廠商

增減變動原因：

(1)E 公司係捷創自有產品原物料主要供應商，因應客戶需求量增加，進貨量增加。

(2)甲公司為 112 年配合新業務備料，113 年備料需求減少。

單位：新台幣千元；%

項目	112 年度				113 年度			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比例	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比例	與發行人之關係
1	柏晶電子(上海)	4,315	16.50	關聯企業	E 公司	8,504	19.33	無
2	C 公司	4,031	15.42	無	柏晶電子(上海)	5,148	11.70	關聯企業
3	甲公司	3,380	12.93	無	D 公司	5,138	11.68	無
4	D 公司	3,263	12.48	無	C 公司	4,939	11.22	無
5	其他	11,157	42.67	無	其他	20,271	46.07	無
	進貨淨額	26,146	100		進貨淨額	44,000	100	

註 1: 已與廠商簽訂保密協定，故以代碼揭露。

三、從業員工資料

單位：人；歲；年；%

項目		年度		截至年報刊印日 114/4/15
		112 年度	113 年度	
員工 人數(人)	管理人員	25	25	30
	一般職員	192	222	227
	合計	217	247	257
平均年歲		35.5	34.5	34.6
平均服務年資		5.5	5.3	5.1
學歷分布比 率 (%)	博士	0.46	0.40	0.41
	碩士	10.14	11.34	12.06
	大專	88.02	87.45	85.21
	高中	1.38	0.81	2.32
	高中以下	0.00	0.00	0.00

#### 四、環保支出資訊

- (一)最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失：無此情事。
- (二)目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：無此情事。

#### 五、勞資關係

- (一)列示各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

##### 1. 各項員工福利措施

本公司為充分照顧員工，保障其生活條件，提供或贊助各項有關福利計劃之推展，並依法成立職工福利委員會，遴選福利委員辦理各項福利措施，每年均訂定福利預算與計畫，以合理有效運用職工福利金。公司內部現行福利措施要項計有生日禮金、福委會各式活動(員工旅遊/員工聚餐)、婚喪喜慶津貼、差旅保險、依照法令之休假制度、年終獎金、績效獎金等。

##### 2. 員工進修及訓練

本公司視公司員工為重要資產，重視人才培育，依各職能需求安排員工專業在職訓練課程與管理課程，包括：內部教育訓練、workshop、及不定期外部訓練，整合企業內外資源，有計劃的培育人才，以培養豐富專業能力及兼具挑戰性之人才，進而提高工作績效，達成公司經營目標。

##### 3. 退休制度與實施狀況

「勞工退休金條例」自九十四年七月一日起施行，六月三十日以前受聘之員工且於七月一日在職者，勞工得選擇繼續適用「勞動基準法」有關之退休金規定，或適用該條例之退休金制度並保留適用該條件前之工作年資。九十四年七月一日以後，新進員工只適用「勞工退休金條例」之退休金制度。本公司依「勞工退休金條例」訂定之員工退休金辦法，係屬確定提撥退休辦法，自九十四年七月一日起，依員工每月薪資百分之六提撥至勞工保險局之個人退休金專戶。

本公司依「勞動基準法」訂定之員工退休辦法，係屬確定給付退休辦法。員工退休金之給付係按服務年資及退休前六個月之平均薪資計算，本公司每月依規定提撥退休準備金，交由勞工退休準備金監督委員會管理，並以該委員會名義存入中央信託局。本公司確定給付退休辦法之退休金已於一一四年度結清。

##### 4. 勞資間之協議

本公司相當重視內部溝通，除召開勞資會議以及員工溝通會議外，公司內部亦開放各種溝通管道，管理階層與員工均互相尊重，並提供意見改善，為公司成長而共同努力。

##### 5. 各項員工權益維護措施情形

本公司各項規定皆依政府法令訂定，訂有完善之制度載明各項管理規範，內容明訂員工權利義務及福利項目，並定期檢討修訂制度內容，以維護所有員工權益。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額及因應措施，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實：無此情形。

## 六、資通安全管理

(一)敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等：

### 1. 資通安全風險管理架構

本公司設立資訊部門專責統籌資訊安全及相關事宜，確保本公司資訊資產之機密、完整性、可用性符合相關法規之要求，嚴格控管執行本公司資訊安全管理，並委由外包專業資訊公司負責協助資訊系統維護及更新，由稽核室依相關內部控制程序管理及定期進行內部稽核，並將相關稽核報告(含追蹤報告)送監察人審閱，於董事會報告稽核業務。

### 2. 資通安全政策

訂定資訊安全管理規範，確保本公司資訊資產之機密與安全及法律遵循，並制定危害發生處理程序以期降低影響至最低。

### 3. 具體管理方案

資通安全管控	資料存取控管	應變復原機制	宣導與檢核
架設防火牆(Firewall)與入侵防護系統(IPS)	電腦設備有專人保管，並設定帳號密碼	定期檢視緊急應變計畫	隨時宣導資訊安全，提升公司員工資安意識
電腦系統與資料儲存媒體配置有全時防毒系統並定期進行病毒掃描	依據職務與專案需求分別賦予不同存取權限	每年定期演練系統復原	每年定期舉行資通安全檢查，並呈報高階管理層
各項網路服務之使用與應用皆依據資通安全政策執行	離職人員停用並取消所有權限	建立系統備份機制，落實異地備份	隨時宣導資訊安全，每年定期舉行資通安全檢查
定期覆核各項系統與網路服務項目之系統紀錄，並追蹤各項異常情況	設備報廢前移除機密性、敏感性與版權軟體或資料，並進行儲存媒體銷毀作業	定期檢討電腦網路安全控制措施	隨時宣導資訊安全，每年定期舉行資通安全檢查
落實系統安全性更新，確保資訊環境安全	遠端登入公司資訊環境應經適當之核准	定期更新檢討改善系統安全	隨時宣導資訊安全，每年定期舉行資通安全檢查

#### 4. 資通安全管理資源

制訂電腦化資訊系統處理作業準則與資通安全管理原則，積極執行資安宣導且不定時進行資安演練以提升內部資訊環境安全。

設有專人定期檢核各項資訊環境設備紀錄，並配合專業資訊委外服務廠商進行系統運作狀況查核、異常追蹤與檢核。

重要資料與系統如 ERP 企業資源規劃、電子傳簽系統等皆定期進行備份並做好異地備份作業，定期進行系統復原演練。

(二) 最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施：無此情形。

#### 七、重要契約

截至年報刊印日止，仍有效存續及最近年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約、長期借款契約及其他足以影響股東權益之重要契約：

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
房屋租賃合約	互億科技(股)公司	2023/5~2028/4	水利路 21 號 3F、4F	無
技術授權合約	甲公司	2022/1 起	授權捷創公司有關於 V93K 之維修/校驗/保養之服務	無
技術授權合約	甲公司	2023/8 起	授權 T 系列維修技術	無
服務合約	甲公司	2012/10	雙方各項服務合約之一般性約定	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動之主要原因及其影響：

單位：新台幣千元；%

項目	年度		增(減)變動	
	112 年度	113 年度	金額	%
流動資產	371,328	580,833	209,505	56.42
採用權益法之投資	55,131	61,790	6,659	12.08
不動產、廠房及設備	82,654	88,541	5,887	7.12
使用權資產	36,208	31,013	(5,195)	(14.35)
其他資產	7,325	6,680	(645)	(8.81)
資產總額	552,646	768,857	216,211	39.12
流動負債	129,348	118,959	(10,389)	(8.03)
非流動負債	30,008	25,487	(4,521)	(15.07)
負債總額	159,356	144,446	(14,910)	(9.36)
普通股股本	140,000	180,000	40,000	28.57
資本公積	136,200	305,840	169,640	124.55
保留盈餘	119,026	138,060	19,034	15.99
其他權益	(1,936)	511	2,447	(126.39)
權益總額	393,290	624,411	231,121	58.77
<p>1.變動原因說明：(變動達 20%以上，且變動金額達新台幣一仟萬元者)</p> <p>(1)流動資產增加：主要係 113 年度辦理現金增資，使現金與約當現金與按攤銷後成本衡量之金融資產合計較 112 年度增加 158,023 千元，及 113 年度第四季營收較 112 年度同期增加，相關應收帳款增加 44,046 千元所致。</p> <p>(2)普通股股本增加：113 年辦理現金增資，使普通股股本增加。</p> <p>(3)資本公積增加：現金增資溢價發行所產生之資本公積。</p> <p>2.影響重大者之未來因應計畫：無。</p>				

## 二、財務績效

最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因及預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

### (一) 經營結果比較分析表：

單位：新台幣千元；%

項目	年度	112 年度	113 年度	增(減)變動	
				金額	%
營業收入淨額		365,606	441,720	76,114	20.82
營業成本		203,205	236,920	33,715	16.59
營業毛利		162,401	204,800	42,399	26.11
營業費用		113,031	148,092	35,061	31.02
營業淨利		49,370	56,708	7,338	14.86
營業外收入及支出		18,214	30,801	12,587	69.11
稅前淨利		67,584	87,509	19,925	29.48
本期淨利		56,699	68,034	11,335	19.99
其他綜合損益淨額		641	2,447	1,806	281.75
本期綜合損益總額		57,340	70,481	13,141	22.92
1.變動原因說明：(變動達 20%以上)					
(1)營業收入與毛利增加：113 年下半年因半導體景氣復甦、測試設備需求增加，使相關設備技術服務、伴隨設備出貨之配件出貨增加及延壽設備服務增加等因素使營業收入與營業毛利較 112 年成長 20.82%與 26.11%。					
(2)營業費用增加：主要係員工人數增加致相關成本增加、現金增資所認列之員工酬勞成本與因獲利增加致員工酬勞提列增加所致。此外 112 年度有預期信用減損迴轉利益計 9,580 千元亦為兩期費用增減數變化之原因。					
(3)營業外收入及支出淨增加：因美元匯率波動，113 年度外幣匯兌利益較 112 年度增加所致。					
(4)其他綜合損益淨額增加：使用權益法之投資之財務報表轉換匯兌差額增加。					
2.對未來財務業務之可能影響及因應計畫：無。					

### (二) 預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

因本公司未編製與公告財務預測，故不適用預期銷售數量及依據，且本公司整體表現尚無重大異常，應無需擬定因應計畫。

本公司未來一年度營業目標，係依據歷年來之實際營業狀況、考量未來市場需求變化，並參酌本公司之產能、人力狀況而訂定。

### 三、現金流量

#### (一) 最近年度現金流量變動情形分析：

單位：新台幣千元；%

項目	年度	112 年度	113 年度	差異	
				金額	比例
營業活動淨現金流入(出)		63,750	68,782	5,032	7.89
投資活動淨現金流入(出)		(26,059)	(116,797)	(90,738)	348.20
籌資活動淨現金流入(出)		(25,807)	90,629	116,436	(451.18)
現金流量變動情形分析：					
1.營業活動淨現金流入(出)：主係 113 年度獲利增加，使淨現金流入增加。					
2.投資活動淨現金流入(出)：主係 113 年度將銀行存款轉三個月以上定存淨增加所致。					
3.籌資活動淨現金流入(出)：主係 113 年度辦理現金增資所致。					

(二) 流動性不足之改善計劃：本公司資金尚屬充裕，未有流動性不足情形。

(三) 未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣千元

期初現金餘額	預計全年來自營業活動淨現金流量	預計全年來自投資及籌資活動淨現金流量	預計現金餘額(不足)數額	預計現金不足額之補救措施	
				投資活動	籌資活動
209,143	100,776	83,688	393,607	不適用	不適用
分析說明：					
1.營業活動：預計 114 年度營業收入較 113 年成長，且獲利增加，來自營業活動將產生淨現金流入。					
2.投資與籌資活動：114 年預計辦理現金增資、發放股利後，預期將仍有淨現金流入。					
3.綜上，本公司預期 114 年度並無預計現金不足額之情事。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

(一) 本公司轉投資政策：

本公司最近年度之轉投資政策以與本公司所在半導體設備或耗材有關之產業為主，對於不熟悉與本業無關之領域，尚無涉入之計畫。此外，本公司對轉投資事業之管理及控制目前訂有內部控制制度「投資循環」、「取得或處分資產處理程序」，以便掌握轉投資事業之財務、業務狀況並監督其經營績效。

(二) 最近年度轉投資獲利或損失之主要原因、改善計畫：

單位:新台幣千元

轉投資公司名稱	主要營業項目	投資比例	原始投資金額	113年12月31日投資餘額	本期認列損益	獲利或虧損原因	改善計畫
Jtron (SAP) Pte Ltd.	半導體設備工程服務業務	29.34%	6,922	19,094	4,081	營運狀況正常	-
Hanbit-Jtron Co., Ltd.	半導體設備工程服務業務	40.00%	3,670	5,448	625	營運狀況正常	-
震鼎集成電路(上海)有限公司	機電產品、電子產品、集成電路零件批發，進出口及相關配套業務	21.33%	26,228	22,742	241	營運狀況正常	每季參與董事會並檢討營業計畫
捷創微精量測股份有限公司	設備儀器校驗服務	39.17%	5,014	12,563	3,847	營運狀況正常	-
捷覈科技股份有限公司	先進探針技術開發與相關耗材買賣	35.00%	1,869	1,943	(576)	技術開發中	定期檢討開發進度

(三) 未來一年投資計畫：預計無重大投資計畫。

六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施。

1. 利率變動

單位：新台幣千元

年度 項目	113年度		114年第一季	
	金額	占營業收入淨額比率	金額	占營業收入淨額比率
利息收入	7,650	1.73%	1,909	1.54%
利息費用	807	0.18%	144	0.12%

資料來源：經會計師查核簽證之財務報告，114年第一季為自結數

本公司 113 年度及 114 年第一季利息收入分別為 7,650 千元及 1,909 千元，占年度營業收入淨額之比率分別為 1.73% 及 1.54%，另本公司利息費用分別為 807 千元及 144 千元，占年度營業收入淨額比率分別為 0.18% 及 0.12%，本公司利息收入及利息支出占營業收入淨額比率不大，故利率變動對本公司之損益影響並不明顯。本公司負債比率低，營運獲利穩定、財務結構健全，且與銀行一直維持良好的往來關係，故可爭取較佳利率水準，亦隨時觀察金融市場利率變化而適時調整資金運用情形。

## 2. 匯率變動

單位：新臺幣千元；%

年度 項目	113 年度		114年第一季	
	金額	占營業收入淨額比率	金額	占營業收入淨額比率
兌換利益(損失)淨額	12,485	2.83%	1,722	1.39%

資料來源：經會計師查核簽證之財務報告，114 年第一季為自結數

本公司 113 年度及 114 年第一季之兌換利益(損失)淨額分別為 12,485 千元及 1,722 千元，占年度營業收入淨額之比率分別為 2.83% 及 1.39%，所佔比例不高，故匯率變動對本公司並無重大影響。本公司部份進銷貨採外幣計價，且現金及銀行存款中，外幣存款佔有重要之比例，故匯率變動對財報獲利穩定度有一定影響。對於匯兌變動，本公司採取下列因應措施：

- A. 採自然避險政策，並控管公司淨部位在一定比例之下。此外，本公司造成匯率曝險之因素主要來自於以外幣計價之營業收入，此部分積極與客戶協商改以新台幣計價等方式來降低匯率變動對本公司所產生的風險。
- B. 隨時蒐集匯率趨勢資訊，並參考專業銀行對匯率走勢看法、市場外幣定存利率報價，取其對本公司有利之財務作為，並適時調整外幣淨部位以規避匯兌風險。

## 3. 通貨膨脹

本公司最近年度及截至公開說明書刊印日止，損益尚未因通貨膨脹而產生重大影響，預測通貨膨脹對本公司損益之影響尚屬有限。未來本公司仍將持續隨時觀察市場景氣與客戶擴產、稼動、庫存水位等指標，並與供應商保持良好之互動，研判通貨膨脹與景氣變化，適時調整產品售價及原物料庫存量，以降低通貨膨脹對公司營運之影響。

- (二) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施。

本公司財務政策以保守穩健為原則，最近年度及截至公開說明書刊印日止，並無從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易。另外本公司已訂定「資金貸與他人作業辦法」、「背書保證辦法」及「取得或處分資產處理程序」等相關辦法，作為本公司未來從事相關作業之遵循依據。

- (三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用。

### 1. 未來研發計畫：

研發重點產品(服務)	計畫目標
影像與機台資訊整合	透過環景影像整合，在即時影像中，產生機台生產資訊及預警機制，可以實現智能工廠自動巡檢、自動偵錯與整合的即時生產資訊

研發重點產品(服務)	計畫目標
智慧生產與智慧實驗室(Smart Manufacturing and Smart Lab.)	透過本公司 Jtron Embedded Edge Platform 產品之運用，能讓傳統的自動化設備由人與機器間之控制介面，進化到機器對機器間之溝通、自動協作並取代原來需要有作業員在現場執行工作，達到 Smart Manufacturing，增加生產效能與效率，實現關燈工廠的目標

## 2. 預計投入研發經費：

本公司投入之研發費用係依據市場長期需求所規劃的新產品及新技術開發進度逐步編列，近年約佔營業收入之 7%~9%，為確保本公司競爭優勢，將視營運狀況及需求隨時調整，持續投入研發經費，以強化研發新品之產出。

### (四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施。

本公司於最近年度及截至年報刊印日止，尚無因國內外重要政策及法律變動而有影響財務業務之情事，且本公司營運依循國內外相關法令及規範執行並隨時注意國內外政策之發展趨勢及法規變動情況，以便及早採取因應措施。

### (五) 科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施。

本公司於最近年度及截至年報刊印日止，尚無因科技改變(包括資通安全風險)及產業變化而有影響財務業務之情事，且本公司隨時注意所處產業相關之技術、發展及改變，並迅速掌握產業動態，加上不斷提升研發能力，且已制定資通安全政策，有效防止資料任意流出或外洩，科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務不至造成重大影響。

### (六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施。

本公司於最近年度及截至年報刊印日止，尚無因企業形象改變而有影響公司危機管理之情事，且本公司一向秉持專業和誠信的經營原則，專注本業經營，遵守法令規定，落實風險控管及維持企業形象，以降低企業風險之發生及對公司之影響。

### (七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無此情形。

### (八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無此情形。

### (九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施。

#### 1. 進貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司主要進貨為維修備品、電子元件、金屬加工件、軟體等，本公司配合之供應商多年來合作關係穩固，其生產品質亦能符合本公司要求，並致力於管理對各家供應廠商進行價格比較、產品品質分析及開發新供應商，以調整控制進貨集中之風險，避免單一供應商進貨比重過高，故截至目前為止供貨情況

良好，並未有供貨短缺或中斷以致影響本公司業務之情形。

2. 銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司銷售對象主要為國際知名半導體及設備大廠，隨著先進製程發展，設備廠亦呈現大者恆大之趨勢發展，而本公司主要客戶於全球測試設備市占率高達5成以上，顯示半導體設備亦屬寡占市場。由於台灣半導體產業擁有完整的供應鏈，無論是晶片設計、晶圓製造、晶片封裝測試等，均在全球具舉足輕重地位，在本公司目前營收來自服務測試設備為主之情形下，因此容易產生銷貨客戶集中情形。本公司基於風險控管，除了與既有客戶建立良好而穩定之合作關係外，亦持續開發新產品/服務及拓展新客戶，藉以提高客戶分散程度，並擴大分散業務來源，降低銷貨集中之風險。

(十) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施。

本公司董事、監察人及持股超過百分之十之大股東於最近年度及截至年報刊印日止，並無因股權大量移轉或更換而對本公司之營運造成重大影響之情事。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施。

本公司最近年度及截至年報刊印日止，尚無經營權改變之情事。

(十二) 訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無此情形。

(十三) 其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：無。

二、私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生本法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

捷創科技股份有限公司



董事長 林益民

